

日立アドバンストサーバ
HA8000シリーズ

HITACHI
Inspire the Next

ユーチャーズガイド

～オプションデバイス編～

HA8000/RS220 AN1/BN1

2015年4月～モデル

マニュアルはよく読み、保管してください。

製品を使用する前に、安全上の指示をよく読み、十分理解してください。
このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

登録商標・商標

HITACHI は、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Intel、インテル、Xeon は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-V は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Red Hat は、米国およびその他の国で Red Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

80 PLUS は、米国 Ecova, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

発行

2015 年 4 月（初版）（廃版）

2016 年 4 月（第3版）

版権

このマニュアルの内容はすべて著作権によって保護されています。このマニュアルの内容の一部または全部を、無断で転載することは禁じられています。

All Rights Reserved, Copyright © 2015, 2016, Hitachi, Ltd.

お知らせ

重要なお知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載したり、複写することは固くお断りします。
- 本書の内容について、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたら、お問い合わせ先へご一報くださいますようお願いいたします。
- 本書に準じないで本製品を運用した結果については責任を負いません。
なお、保証と責任については保証書裏面の「保証規定」をお読みください。

システム装置の信頼性について

ご購入いただきましたシステム装置は、一般事務用を意図して設計・製作されています。生命、財産に著しく影響のある高信頼性を要求される用途への使用は意図されていませんし、保証もされていません。このような高信頼性を要求される用途へは使用しないでください。

高信頼性を必要とする場合には別システムが必要です。弊社営業部門にご相談ください。

一般事務用システム装置が不適当な、高信頼性を必要とする用途例

・化学プラント制御　・医療機器制御　・緊急連絡制御など

規制・対策などについて

□ 電波障害自主規制について

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

□ 電源の瞬時電圧低下対策について

本製品は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対して不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお勧めします。

□ 高調波電流規格：JIS C 61000-3-2 適合品

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性 第3-2部：限度値—高調波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が 20A 以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

□ 雑音耐力について

本製品の外來電磁波に対する耐力は、国際電気標準会議規格 IEC61000-4-3「放射無線周波電磁界イミュニティ試験」のレベル2に相当する規定に合致していることを確認しております。

なお、レベル2とは、対象となる装置に近づけないで使用されている低出力の携帯型トランシーバから受ける程度の電磁環境です。

□ 輸出規制について

本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規制など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、お買い求め先にお問い合わせください。

また、本製品に付属する周辺機器やソフトウェアも同じ扱いとなります。

□ 海外での使用について

本製品は日本国内専用です。国外では使用しないでください。

なお、他国には各々の国で必要となる法律、規格などが定められており、本製品は適合していません。

□ システム装置の廃棄について

事業者が廃棄する場合、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の発行が義務づけられています。詳しくは、各都道府県産業廃棄物協会にお問い合わせください。産業廃棄物管理票は（社）全国産業廃棄物連合会に用意されています。

個人が廃棄する場合、お買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則にしたがってください。

また、システム装置内の電池を廃棄する場合もお買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則にしたがってください。

システム装置の廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

システム装置を譲渡あるいは廃棄するときには、ハードディスク／SSD の重要なデータ内容を消去する必要があります。

ハードディスク／SSD 内に書き込まれた「データを消去する」という場合、一般に

- データを「ゴミ箱」に捨てる
- 「削除」操作を行う
- 「ゴミ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ソフトで初期化（フォーマット）する
- OS を再インストールする

などの作業をしますが、これらのことをして、ハードディスク／SSD 内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけです。つまり、一見消去されたように見えますが、OS のもとでそれらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけであり、本来のデータは残っているという状態にあります。

したがって、データ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、システム装置のハードディスク／SSD 内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

ハードディスク／SSD 上の重要なデータの流出を回避するため、システム装置を譲渡あるいは廃棄をする前に、ハードディスク／SSD に記録された全データをお客様の責任において消去することが非常に重要です。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）を利用するか、ハードディスク／SSD を金づちや強磁気により物理的・磁気的に破壊して、データを読めなくすることをお勧めします。

なお、ハードディスク／SSD 上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくシステム装置を譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十分な確認を行なう必要があります。

はじめに

このたびは日立のシステム装置をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このマニュアルは、システム装置に内蔵するオプションデバイスの取り付けについて記載しています。

マニュアルの表記

このマニュアルの表記ルールについて説明します。

なお、マニュアルで説明している画面やイラストは一例であり、またマニュアル制作時点のものです。製品や製品の出荷時期により異なる場合があります。

□ マニュアル内の記号

マニュアル内で使用しているマークの意味は次のとおりです。

 警告	これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
 注意	これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
 通知	これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。
 制限	システム装置の故障や障害の発生を防止し、正常に動作させるための事項を示します。
 補足	システム装置を活用するためのアドバイスを示します。

□ システム装置の表記

このマニュアルでは、システム装置を装置と略して表記することができます。

また、システム装置を区別する場合には次のモデル名で表記します。

RS220 AN1/BN1 モデル

システム装置のモデルを省略して

RS220 xN1 モデル

と表記することもあります。

□ オペレーティングシステム（OS）の略称について

このマニュアルでは、次の OS 名称を省略して表記します。

- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard 日本語版
(以下 Windows Server 2012 R2 Standard または Windows Server 2012 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter 日本語版
(以下 Windows Server 2012 R2 Datacenter または Windows Server 2012 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2012 Standard 日本語版
(以下 Windows Server 2012 Standard または Windows Server 2012、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter 日本語版
(以下 Windows Server 2012 Datacenter または Windows Server 2012、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版
(以下 Windows Server 2008 R2 Standard または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise 日本語版
(以下 Windows Server 2008 R2 Enterprise または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter 日本語版
(以下 Windows Server 2008 R2 Datacenter または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Red Hat Enterprise Linux Server 7.2 (64-bit x86_64)
(以下 RHEL7.2 (64-bit x86_64) または RHEL7.2、RHEL7、Linux)
- Red Hat Enterprise Linux Server 7.1 (64-bit x86_64)
(以下 RHEL7.1 (64-bit x86_64) または RHEL7.1、RHEL7、Linux)
- Red Hat Enterprise Linux Server 6.6 (64-bit x86_64)
(以下 RHEL6.6 (64-bit x86_64) または RHEL6.6、RHEL6、Linux)
- Red Hat Enterprise Linux Server 6.6 (32-bit x86)
(以下 RHEL6.6 (32-bit x86) または RHEL6.6、RHEL6、Linux)
- VMware vSphere® ESXi™ 6.0
(以下 VMware vSphere ESXi 6.0 または VMware vSphere ESXi、VMware)
- VMware vSphere® ESXi™ 5.5
(以下 VMware vSphere ESXi 5.5 または VMware vSphere ESXi、VMware)

次のとおり、省略した「OS 表記」は、「対象 OS」中のすべてまたは一部を表すときに用います。

OS 表記	対象 OS
Windows Server 2012 R2 Standard *1	・ Windows Server 2012 R2 Standard *1
Windows Server 2012 R2 Datacenter *1	・ Windows Server 2012 R2 Datacenter *1
Windows Server 2012 R2 *1	・ Windows Server 2012 R2 Standard *1 ・ Windows Server 2012 R2 Datacenter *1
Windows Server 2012 Standard *1	・ Windows Server 2012 Standard *1
Windows Server 2012 Datacenter *1	・ Windows Server 2012 Datacenter *1
Windows Server 2012 *1	・ Windows Server 2012 Standard *1 ・ Windows Server 2012 Datacenter *1
Windows Server 2008 R2 Standard *1	・ Windows Server 2008 R2 Standard *1
Windows Server 2008 R2 Enterprise *1	・ Windows Server 2008 R2 Enterprise *1
Windows Server 2008 R2 Datacenter *1	・ Windows Server 2008 R2 Datacenter *1
Windows Server 2008 R2 *1	・ Windows Server 2008 R2 Standard *1 ・ Windows Server 2008 R2 Enterprise *1 ・ Windows Server 2008 R2 Datacenter *1

OS 表記	対象 OS
Windows	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2012 R2 Standard *1 Windows Server 2012 R2 Datacenter *1 Windows Server 2012 Standard *1 Windows Server 2012 Datacenter *1 Windows Server 2008 R2 Standard *1 Windows Server 2008 R2 Enterprise *1 Windows Server 2008 R2 Datacenter *1
RHEL7.2 RHEL7	<ul style="list-style-type: none"> RHEL7.2 (64-bit x86_64)
RHEL7.1 RHEL7	<ul style="list-style-type: none"> RHEL7.1 (64-bit x86_64)
RHEL6.6 RHEL6	<ul style="list-style-type: none"> RHEL6.6 (64-bit x86_64) RHEL6.6 (32-bit x86)
Linux	<ul style="list-style-type: none"> RHEL7.2 (64-bit x86_64) RHEL7.1 (64-bit x86_64) RHEL6.6 (64-bit x86_64) RHEL6.6 (32-bit x86)
VMware vSphere ESXi 6.0	<ul style="list-style-type: none"> VMware vSphere ESXi 6.0
VMware vSphere ESXi 5.5	<ul style="list-style-type: none"> VMware vSphere ESXi 5.5
VMware vSphere ESXi VMware	<ul style="list-style-type: none"> VMware vSphere ESXi 6.0 VMware vSphere ESXi 5.5

*1 64bit 版のみ提供されます。

また、Windows の Service Pack についても SP と表記します。

□ 略語・用語

マニュアルやユーティリティ、Web コンソールなどで使用している略語と用語は次のとおりです。

略語・用語	説明
BIOS	Basic Input/Output System
BMC	Baseboard Management Controller (システム装置のハードウェア監視機能を提供する管理用コントローラ)
CPU	Central Processing Unit
DIMM	Dual Inline Memory Module (メモリーボード)
EFI	Extensible Firmware Interface (BIOS を代替する、OS とファームウェアのインターフェース仕様)
FCB	Front Connector Board (システム装置前面のコネクタ／ランプ／ボタンを搭載するボード)
FRU	Field Replaceable Unit (フィールド交換可能ユニット)
HDDBP	HDD Back Plane (ハードディスク／SSD と接続するコネクタを搭載するボード)
IPMI	Intelligent Platform Management Interface (システムや OS に依存することなく、システム装置のハードウェアを監視するための標準インターフェース仕様)
KVM	Keyboard, Video, Mouse
MB	Mother Board (マザーボード)
MC	Management Controller (BMC や ME などの総称)
ME	Management Engine (システム装置の電力管理を行うチップ)
NMI	Non-Maskable Interrupt (マスク不可能なハードウェア割り込み)
PCI	Peripheral Component Interconnect/Interface
PCIe	PCI Express
PROC	PROcessor (プロセッサー、CPU)
PSU	Power Supply Unit (電源ユニット)

略語・用語	説明
SDR	Sensor Data Record（ファームウェアがハードウェア監視に使用するセンサデータ）
SEL	System Event Log（システム装置のイベントログ情報）
SPI Mezzanine	MB に実装する拡張カード
UEFI	Unified EFI
Web コンソール	HTTP/HTTPS プロトコル経由で BMC によるリモートマネジメントを利用するための Web ブラウザと、リモートマネジメント制御を行うためのコンテンツ
リモート KVM	システム装置のローカルコンソールを、ネットワークを介してリモート端末（管理 PC）の Web ブラウザに表示する機能
リモートメディア	リモート端末に接続されている CD/DVD ドライブ、フロッピーディスクドライブ、ISO イメージファイル、USB メモリーを、システム装置に仮想ドライブとして認識させる機能
リモートマネジメント拡張ライセンス	リモート KVM / リモートメディア機能を使用するために必要なライセンス

□ おまかせ安心モデル / おまかせ安心ロングライフモデルの種類と表記

おまかせ安心モデルとおまかせ安心ロングライフモデルは、サービスレベルによりそれぞれ 3 タイプに分類されています。

次の表のとおり、「表記モデル名」は「実モデル名」の 3 タイプを表します。

表記モデル名	実モデル名
おまかせ安心モデル	<ul style="list-style-type: none"> ・ おまかせ安心モデルⅡ ・ おまかせ安心モデルⅡ 24 ・ おまかせ安心モデル
おまかせ安心ロングライフモデル	<ul style="list-style-type: none"> ・ おまかせ安心ロングライフモデルⅡ ・ おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 ・ おまかせ安心ロングライフモデル

□ おまかせ安心長期保守モデルの種類と表記

おまかせ安心長期保守モデルは、サービスレベルにより 2 タイプに分類されています。

次の表のとおり、「表記モデル名」は「実モデル名」の 2 タイプを表します。

表記モデル名	実モデル名
おまかせ安心長期保守モデル	<ul style="list-style-type: none"> ・ おまかせ安心長期保守モデルⅡ ・ おまかせ安心長期保守モデルⅡ 24

安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために

安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって表示されます。これは安全警告記号と「警告」、「注意」および「通知」という見出し語を組み合わせたものです。



これは、安全警告記号です。人への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起するために用います。起こりうる傷害または死を回避するためにこのシンボルのあとに続く安全に関するメッセージにしたがってください。



これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。



これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。

通知

これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。



【表記例 1】感電注意

△の図記号は注意していただきたいことを示し、△の中に「感電注意」などの注意事項の絵が描かれています。



【表記例 2】分解禁止

○の図記号は行ってはいけないことを示し、○の中に「分解禁止」などの禁止事項の絵が描かれています。

なお、○の中に絵がないものは、一般的な禁止事項を示します。



【表記例 3】電源プラグをコンセントから抜け

●の図記号は行っていただきたいことを示し、●の中に「電源プラグをコンセントから抜け」などの強制事項の絵が描かれています。

なお、!は一般的に行っていただきたい事項を示します。

安全に関する共通的な注意について

次に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

- 操作は、このマニュアル内の指示、手順にしたがって行ってください。
- 本製品やマニュアルに表示されている注意事項は必ず守ってください。
- 本製品に搭載または接続するオプションなど、ほかの製品に添付されているマニュアルも参照し、記載されている注意事項を必ず守ってください。

これらを怠ると、人身上的傷害やシステムを含む財産の損害を引き起こすことがあります。

操作や動作は

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。

本製品について何か問題がある場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い求め先にご連絡いただなかば保守員をお呼びください。

自分自身でもご注意を

本製品やマニュアルに表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予測を超えた事態が起こることが考えられます。操作にあたっては、指示にしたがうだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。

一般的な安全上の注意事項

本製品の取り扱いにあたり次の注意事項を常に守ってください。



電源コードの取り扱い

電源コードは付属のものおよびサポートオプションを使用し、次のことについて注意して取り扱ってください。取り扱いを誤ると、電源コードの銅線が露出したり、ショートや一部断線で過熱して、感電や火災の原因となります。

- 物を載せない
- 引っぱらない
- 押し付けない
- 折り曲げない
- ねじらない
- 加工しない
- 熱器具のそばで使用しない
- 加熱しない
- 束ねない
- ステップルなどで固定しない
- コードに傷が付いた状態で使用しない
- 紫外線や強い可視光線を連続して当てる
- アルカリ、酸、油脂、湿気へ接触させない
- 高温環境で使用しない
- 定格以上で使用しない
- ほかの装置で使用しない
- 電源プラグを持たずにコンセントの抜き差しをしない
- 電源プラグをぬれた手で触らない

なお、電源プラグはすぐに抜けるよう、コンセントの周りには物を置かないでください。



タコ足配線

同じコンセントに多数の電源プラグを接続するタコ足配線はしないでください。コードやコンセントが過熱し、火災の原因となるとともに、電力使用量オーバーでブレーカーが落ち、ほかの機器にも影響を及ぼします。



電源プラグの接触不良やトラッキング

電源プラグは次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因となります。

- 電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。
- 電源プラグはほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は乾いた布などで拭き取ってから差し込んでください。
- グラグラしないコンセントを使用してください。
- コンセントの工事は、専門知識を持った技術者が行ってください。



電池の取り扱い

電池の交換は保守員が行います。交換は行わないでください。また、次のことについて注意してください。取り扱いを誤ると過熱・破裂・発火などでの原因となります。

- 充電しない
- ショートしない
- 分解しない
- 加熱しない
- 変形しない
- 焼却しない
- 水にぬらさない



修理・改造・分解

本マニュアルに記載のない限り、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因となります。特に電源ユニット内部は高电压部が数多くあり、万一触ると危険です。



レーザー光

DVD-ROM ドライブ、DVD-RAM ドライブや LAN の SFP+ モジュールなどレーザーデバイスの内部にはレーザー光を発生する部分があります。分解・改造をしないでください。また、内部をのぞきこんだりしないでください。レーザー光により視力低下や失明のおそれがあります。（レーザー光は目に見えない場合があります。）



梱包用ポリ袋

装置の梱包用エーキャップなどのポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かないでください。かぶつたりすると窒息するおそれがあります。



電源コンセントの取り扱い

電源コンセントは、使用する電圧および電源コードに合ったものを使用してください。その他のコンセントを使用すると感電のおそれがあります。
→『ユーザーズガイド～導入編～』



目的以外の使用

踏み台やブックエンドなど、PC サーバとしての用途以外にシステム装置を利用しないでください。壊れたり倒れたりし、けがや故障の原因となります。



信号ケーブル

- ケーブルは足などを引っかけたり、引っぱったりしないように配線してください。引っかけたり、引っぱったりするとけがや接続機器の故障の原因となります。また、データ消失のおそれがあります。
- ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接続機器などの故障の原因となります。



装置上に物を置く

システム装置の上には周辺機器や物を置かないでください。周辺機器や物がすべり落ちてけがの原因となります。また、置いた物の荷重によってはシステム装置の故障の原因となります。



ラックキャビネット搭載時の取り扱い

ラックキャビネット搭載時、装置上面の空きエリアを棚または作業空間として使用しないでください。装置上面の空きエリアに重量物を置くと、落下によるけがの原因となります。



眼精疲労

ディスプレイを見る環境は 300 ~ 1000 ルクスの明るさにしてください。また、ディスプレイを見続ける作業をするときは1時間に10分から15分ほど休憩してください。長時間ディスプレイを見続けると目に疲労が蓄積され、視力の低下を招くおそれがあります。

装置の損害を防ぐための注意

装置使用環境の確認



装置の使用環境は『ユーザーズガイド～導入編～』に示す条件を満足してください。たとえば、温度条件を超える高温状態で使用すると、内部の温度が上昇し装置の故障の原因となります。

使用的する電源



使用できる電源は AC100V または AC200V です。それ以外の電圧では使用しないでください。電圧の大きさにしたがって内部が破損したり過熱・劣化して、装置の故障の原因となります。

温度差のある場所への移動



移動する場所間で温度差が大きい場合は、表面や内部に結露することがあります。結露した状態で使用すると装置の故障の原因となります。すぐに電源を入れたりせず、使用する場所で数時間そのまま放置し、室温と装置内温度がほぼ同じに安定してから使用してください。たとえば、5 °C の環境から 25 °C の環境に持ち込む場合、2 時間ほど放置してください。

通気孔



通気孔は内部の温度上昇を防ぐためのものです。物を置いたり立てかけたりして通気孔をふさがないでください。内部の温度が上昇し、発煙や故障の原因となります。また、通気孔は常にほこりが付着しないよう、定期的に点検し、清掃してください。

装置内部への異物の混入



装置内部への異物の混入を防ぐため、次のことに注意してください。異物によるショートや異物のたい積による内部温度上昇が生じ、装置の故障の原因となります。

- 通気孔などから異物を中に入れない
- 花瓶、植木鉢などの水の入った容器や虫ピン、クリップなどの小さな金属類を装置の上や周辺に置かない
- 装置のカバーを外した状態で使用しない

強い磁気の発生体



磁石やスピーカなどの強い磁気を発生するものを近づけないでください。システム装置の故障の原因となります。

落下などによる衝撃



落させたりぶつけるなど、過大な衝撃を与えないでください。内部に変形や劣化が生じ、装置の故障の原因となります。

接続端子への接触



コネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしてショートさせないでください。発煙したり接触不良の故障の原因となります。

煙霧状の液体



煙霧状の殺虫剤などを使用するときは、事前にビニールシートなどでシステム装置を完全に包んでください。システム装置内部に入り込むと故障の原因となります。また、このときシステム装置の電源は切ってください。

装置の輸送



システム装置を輸送する場合、常に梱包を行ってください。また、梱包する際はマザーボード側（システム装置背面から見てコネクタ類のある側）が下となるよう、向きに注意してください。梱包しなかったり、間違った向きで輸送すると、装置の故障の原因となります。

なお、工場出荷時の梱包材の再利用は1回のみ可能です。

サポート製品の使用



流通商品のハードウェア・ソフトウェア（他社から購入される Windows も含む）を使用した場合、システム装置が正常に動作しなくなったり故障したりすることがあります。

この場合の修理対応は有償となります。システム装置の安定稼働のためにも、サポートしている製品を使用してください。

バックアップ



ハードディスク／SSD のデータなどの重要な内容は、補助記憶装置にバックアップを取ってください。ハードディスク／SSD が壊れると、データなどがすべてなくなってしまいます。



ディスクアレイを構成するハードディスク ／SSD の複数台障害

リビルドによるデータの復旧、およびリビルド後のデータの正常性を保証することはできません。リビルドを行ってディスクアレイ構成の復旧に成功したように見えても、リビルド作業中に読めなかったファイルは復旧できません。

障害に備え、必要なデータはバックアップを取ってください。

なお、リビルドによるデータ復旧が失敗した場合のリストアについては、お客様ご自身で行っていただく必要があります。

（リビルドによる復旧を試みる分、復旧に時間がかかります。）

本マニュアル内の警告表示

⚠ 警告

本マニュアル内にはありません。

⚠ 注意

内蔵オプションの増設・交換

内蔵オプションの増設・交換はすべて保守員が行います。システム装置のカバーの取り外しや内蔵オプションの取り付け・取り外しは行わないでください。不慣れな作業を行うことにより、けがをしたり装置の故障の原因となります。

『関連ページ』 → P.5、P.14、P.23、P.37、P.44、P.49

通知

ハードディスク／SSD の取り扱い

ハードディスク／SSD は次のとおり取り扱ってください。取り扱い方法によっては、ハードディスク／SSD の故障やデータの消失の原因となります。

- システム装置やハードディスク／SSDを持ち運ぶときは、振動や衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。また、ハードディスク／SSD を取り扱うときには静電気をあらかじめ取り除くか、綿手袋を着用してください。
- システム装置を移動させるときは電源を切り、電源プラグを抜いて 30 秒以上待ってから行ってください。

『関連ページ』 → P.19

拡張ボードの取り付け

拡張ボードを決められた拡張スロット以外に取り付けたり、またサポートしていない拡張ボードを取り付けたりしないでください。正しく動作しなかったり、システム装置や拡張ボードが故障するおそれがあります。

『関連ページ』 → P.37

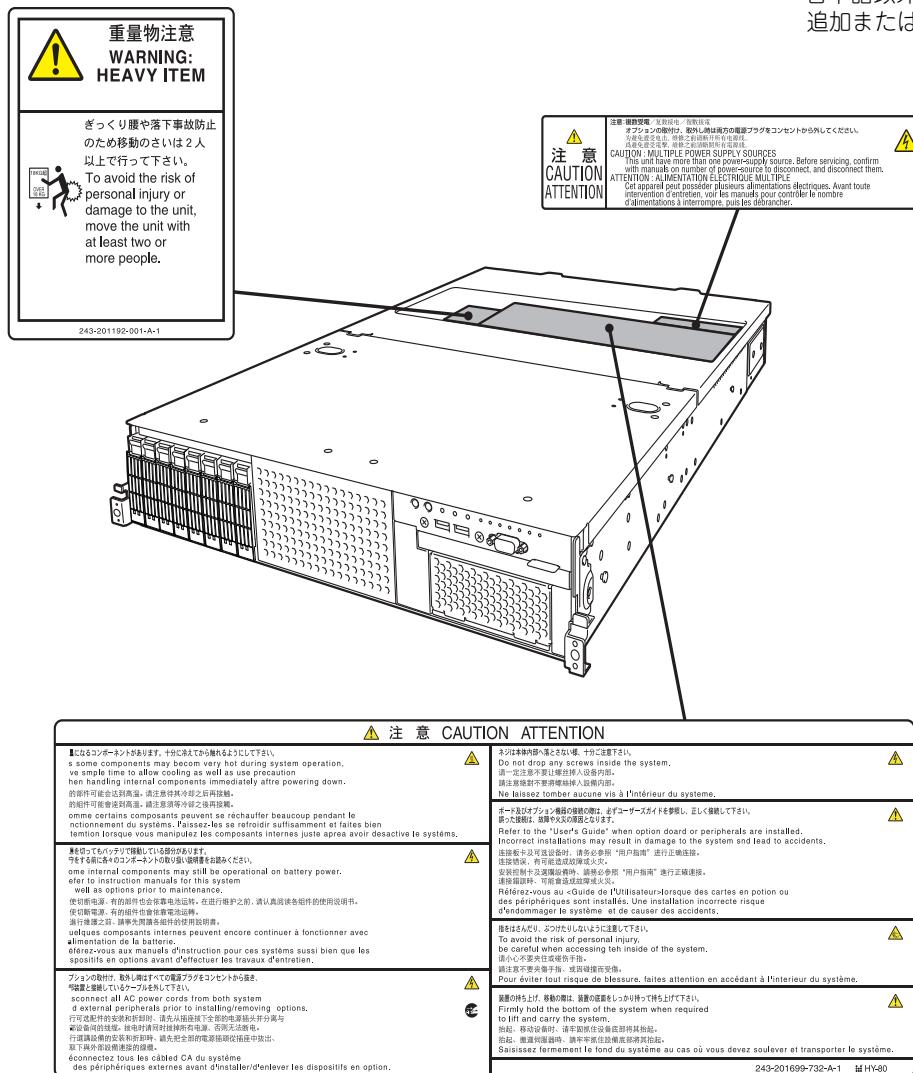
安全にお使いいただくために（続き）

警告ラベルについて

警告ラベルはシステム装置の次に示す箇所に貼り付けられています。

システム装置を取り扱う前に、警告ラベルが貼り付けられていること、および警告ラベルの内容をご確認ください。もし警告ラベルが貼り付けられていなかったり、はがれやかすれなどで読みづらかったりする場合は、お買い求め先にご連絡いただくか、保守員をお呼びください。

また、警告ラベルは汚したりはがしたりしないでください。



* 日本語以外の言語による注意書きは、追加または削除されることがあります。

目次

登録商標・商標	ii
発行	ii
版権	ii
お知らせ	iii
重要なお知らせ	iii
システム装置の信頼性について	iii
規制・対策などについて	iii
システム装置の廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意	v
はじめに	vi
マニュアルの表記	vi
安全にお使いいただくために	x
一般的な安全上の注意事項	xi
装置の損害を防ぐための注意	xiii
本マニュアル内の警告表示	xv
警告ラベルについて	xvi
目次	xvii
1 プロセッサーの取り付け	1
1.1 プロセッサーの種類	2
1.2 プロセッサーの取り付け位置	4
1.3 プロセッサーの取り付け	5
2 メモリーボードの取り付け	7
2.1 メモリーボードの種類	8
2.2 メモリーボードの取り付け位置	9
2.2.1 メモリースロット	9
2.2.2 メモリーボードの搭載ルール	10
2.3 メモリーボードの取り付け	14
3 内蔵デバイスの取り付け	15
3.1 内蔵デバイスの種類	16
3.1.1 内蔵ハードディスク／内蔵 SSD	16
3.1.2 内蔵 DVD ドライブ	17
3.1.3 内蔵 LTO ／内蔵 RDX	17

3.2 内蔵デバイスの取り付け位置	18
3.2.1 拡張ストレージベイ	18
3.2.2 内蔵デバイス搭載ルール	20
3.3 内蔵デバイスの取り付け	23
4 拡張ボードの取り付け	25
4.1 拡張ボードの種類	26
4.2 拡張ボードの取り付け位置	29
4.2.1 拡張スロット	29
4.2.2 拡張ボードの搭載ルール	31
4.3 拡張ボードの取り付け	37
5 電源ユニットの取り付け	39
5.1 電源ユニットの種類	40
5.2 電源ユニットの取り付け位置	41
5.2.1 電源スロット	41
5.2.2 電源ユニットの搭載ルール	41
5.3 電源ユニットに接続する電源コード	43
5.4 電源ユニットの取り付け	44
6 システムファンの取り付け	45
6.1 システムファンの種類	46
6.2 システムファンの取り付け位置	47
6.2.1 システムファンスロット	47
6.2.2 システムファンの搭載ルール	48
6.3 システムファンの取り付け	49
付録 A メモリーの仕様と制限	51
A.1 メモリーの動作クロック	52
A.2 メモリーホール	53
索引	55

1

プロセッサーの取り付け

この章では、システム装置に搭載可能なプロセッサーの種類と取り付け位置について説明します。なお、プロセッサーの取り付けは保守員が行います。お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

1.1 プロセッサーの種類	2
1.2 プロセッサーの取り付け位置	4
1.3 プロセッサーの取り付け	5

1.1 プロセッサーの種類

システム装置に搭載可能なプロセッサーの形名と仕様は次のとおりです。

品名	形名	仕様
Xeon プロセッサー E5-2699v3	ECB993	2.30GHz/18コア/3次キャッシュ 45MB、スロット1用
	SECB993B	2.30GHz/18コア/3次キャッシュ 45MB、スロット2用、増設用システムファン1個付き
	SECB9930CEX *1	2.30GHz/18コア/3次キャッシュ 45MB、スロット1用、長期保守専用
	SECB993BCEX *1 *2	2.30GHz/18コア/3次キャッシュ 45MB、スロット2用、増設用システムファン1個付き、長期保守専用
Xeon プロセッサー E5-2697v3	ECB973	2.60GHz/14コア/3次キャッシュ 35MB、スロット1用
	SECB973B	2.60GHz/14コア/3次キャッシュ 35MB、スロット2用、増設用システムファン1個付き
	SECB9730CEX *1	2.60GHz/14コア/3次キャッシュ 35MB、スロット1用、長期保守専用
	SECB973BCEX *1 *2	2.60GHz/14コア/3次キャッシュ 35MB、スロット2用、増設用システムファン1個付き、長期保守専用
Xeon プロセッサー E5-2690v3	ECB903	2.60GHz/12コア/3次キャッシュ 30MB、スロット1用
	SECB903B	2.60GHz/12コア/3次キャッシュ 30MB、スロット2用、増設用システムファン1個付き
	SECB9030CEX *1	2.60GHz/12コア/3次キャッシュ 30MB、スロット1用、長期保守専用
	SECB903BCEX *1 *2	2.60GHz/12コア/3次キャッシュ 30MB、スロット2用、増設用システムファン1個付き、長期保守専用
Xeon プロセッサー E5-2660v3	ECB603	2.60GHz/10コア/3次キャッシュ 25MB、スロット1用
	SECB603B	2.60GHz/10コア/3次キャッシュ 25MB、スロット2用、増設用システムファン1個付き
	SECB6030CEX *1	2.60GHz/10コア/3次キャッシュ 25MB、スロット1用、長期保守専用
	SECB603BCEX *1 *2	2.60GHz/10コア/3次キャッシュ 25MB、スロット2用、増設用システムファン1個付き、長期保守専用
Xeon プロセッサー E5-2640v3	ECB403	2.60GHz/8コア/3次キャッシュ 20MB、スロット1用
	SECB403B	2.60GHz/8コア/3次キャッシュ 20MB、スロット2用、増設用システムファン1個付き
	SECB4030CEX *1	2.60GHz/8コア/3次キャッシュ 20MB、スロット1用、長期保守専用
	SECB403BCEX *1 *2	2.60GHz/8コア/3次キャッシュ 20MB、スロット2用、増設用システムファン1個付き、長期保守専用
Xeon プロセッサー E5-2637v3	ECB373	3.50GHz/4コア/3次キャッシュ 15MB、スロット1用
	SECB373B	3.50GHz/4コア/3次キャッシュ 15MB、スロット2用、増設用システムファン1個付き
	SECB3730CEX *1	3.50GHz/4コア/3次キャッシュ 15MB、スロット1用、長期保守専用
	SECB373BCEX *1 *2	3.50GHz/4コア/3次キャッシュ 15MB、スロット2用、増設用システムファン1個付き、長期保守専用

品名	形名	仕様
Xeon プロセッサー E5-2620v3	ECB203	2.40GHz/6コア /3次キャッシュ 15MB、スロット1用
	SECB203B	2.40GHz/6コア /3次キャッシュ 15MB、スロット2用、 増設用システムファン1個付き
	SECB2030CEX *1	2.40GHz/6コア /3次キャッシュ 15MB、スロット1用、 長期保守専用
	SECB203BCEX *1 *2	2.40GHz/6コア /3次キャッシュ 15MB、スロット2用、 増設用システムファン1個付き、長期保守専用
Xeon プロセッサー E5-2603v3	ECB033	1.60GHz/6コア /3次キャッシュ 15MB、スロット1用
	SECB033B	1.60GHz/6コア /3次キャッシュ 15MB、スロット2用、 増設用システムファン1個付き
	SECB0330CEX *1	1.60GHz/6コア /3次キャッシュ 15MB、スロット1用、 長期保守専用
	SECB033BCEX *1 *2	1.60GHz/6コア /3次キャッシュ 15MB、スロット2用、 増設用システムファン1個付き、長期保守専用

*1 長期保守対応モデル、およびおまかせ安心長期保守モデルは、このオプションのみサポートしています。
なお、長期保守対応モデルおよびおまかせ安心長期保守モデルは、RS220 AN1 モデルにのみラインナップしています。

*2 サポート形名は「GU-SECB***BCEX」となります。



- プロセッサーを2個搭載する場合、同じ仕様のものを搭載してください。
仕様が異なるプロセッサーが混在すると、システム装置は正常に動作しません。
- プロセッサースロット1には形名"ECB***"または"SECB****CEX"、プロセッサースロット2には形名 "SECB***B" または "SECB***BCEX" ("*" はプロセッサースロット1、2ともに同じ英数字) を搭載してください。添付される増設用システムファンの有無が異なります。
- XeonプロセッサーE5-2699v3を2個搭載した構成でWindows Server 2008 R2 Hyper-V 2.0を使用する場合、Hyper-V 2.0の論理プロセッサー数制限（最大64プロセッサー）によりHyper-Threadingを無効にする必要があります。
詳細は『ユーザーズガイド～BIOS編～』をご参照ください。



- 購入されたプロセッサーの形名は、購入品に添付された『添付品一覧』で確認できます。
- プロセッサーのステッピング（リビジョン）が異なるものが混在する場合、Windowsにおいてはイベントビューアのシステムログに次のようなログが採取されますが、動作上問題ありません。



1.2 プロセッサーの取り付け位置

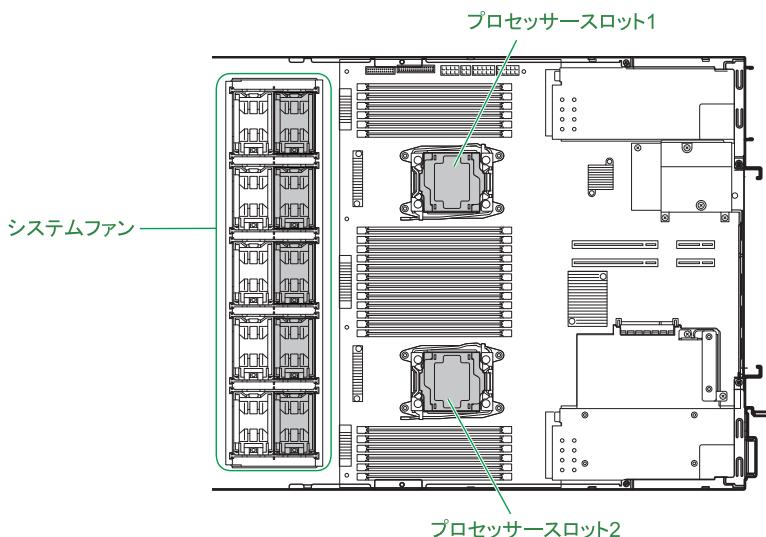
プロセッサーは、マザーボード上のプロセッサースロットに取り付けます。

システム装置は最大2プロセッサーまでのマルチプロセッシング（複数のプロセッサーを搭載）が可能です。

プロセッサースロットの位置は次のとおりです。プロセッサースロット1から順に搭載します。

なお、プロセッサーを2個搭載する場合、システムファンを1個増設する必要があります。

→ 「6 システムファンの取り付け」 P.45



また、プロセッサーを2個搭載した場合、メモリーボードの増設などメモリー構成を変更する必要があります。

→ 「2 メモリーボードの取り付け」 P.7



- プロセッサースロット1にはプロセッサーを搭載してください。システム装置が動作しません。
- プロセッサーを2個搭載する場合、システム装置に搭載している電源ユニットの電源容量が1000Wタイプ(BP2372)であることを確認してください。電源容量が800Wタイプ(BP2371)または800Wタイプ200V用(BP2363)の電源ユニットを搭載している場合、正常に動作しないことがあります。



搭載するプロセッサーの数により、必要なシステムファンの数が異なります。
プロセッサー搭載数によるシステムファン必要数は次のとおりです。

- プロセッサー1個搭載：システムファン4個
- プロセッサー2個搭載：システムファン5個

また、システムファンキット(SBF7101/BF7100)の増設により、システムファンを冗長化した場合は次のとおりです。

- プロセッサー1個搭載：システムファン8個(SBF7101)
- プロセッサー2個搭載：システムファン10個(SBF7101+BF7100)

システムファンキットの詳細は、「6 システムファンの取り付け」 P.45をご参照ください。

1.3 プロセッサーの取り付け

プロセッサーの取り付けは保守員が行います。お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

⚠ 注意

内蔵オプションの増設・交換はすべて保守員が行います。システム装置のカバーの取り外しや内蔵オプションの取り付け・取り外しは行わないでください。不慣れな作業を行うことにより、けがをしたり装置の故障の原因となります。



システム装置の構成を変更した場合、最大 / 最少消費電力の値を再測定するため、システム BIOS の「Power Measurement Policy」を「One Time」に設定し、システム装置を起動する必要があります。消費電力の再測定を行わないと、正しい値を BMC が認識できず、省電力機能が機能しないおそれがあります。

システム BIOS 設定の詳細は、『ユーザーズガイド～BIOS 編～』をご参照ください。

— MEMO —

2

メモリー ボードの取り付け

この章では、システム装置に搭載可能なメモリー ボードの種類と取り付け位置について説明します。なお、メモリー ボードの取り付けは保守員が行います。お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

2.1 メモリー ボードの種類	8
2.2 メモリー ボードの取り付け位置	9
2.3 メモリー ボードの取り付け	14

2.1 メモリーボードの種類

システム装置に搭載可能なメモリーボードは、次のとおりです。

メモリーボードは 10 種類あります。出荷時のメモリー RAS モードにより、搭載できるメモリーボードが異なります。

品名	形名	仕様
メモリーボード (RDIMM)	MJ7008R0	8GB (4GB×2枚)、2133MHz、DDR4、Registered DIMM
	MJ7016R0 *1	16GB (8GB×2枚)、2133MHz、DDR4、Registered DIMM
	MJ7032R0 *1	32GB (16GB×2枚)、2133MHz、DDR4、Registered DIMM
メモリーボード (LRDIMM)	MJ7064N0	64GB (32GB×2枚)、2133MHz、DDR4、Load-Reduced DIMM
メモリーボード (RDIMM)	MJ7016R0MEX *2	16GB (8GB×2枚)、2133MHz、DDR4、Registered DIMM
	MJ7032R0MEX *2	32GB (16GB×2枚)、2133MHz、DDR4、Registered DIMM
メモリーボード (RDIMM)	MJ7016R0LEX *3	16GB (8GB×2枚)、2133MHz、DDR4、Registered DIMM
	MJ7032R0LEX *3	32GB (16GB×2枚)、2133MHz、DDR4、Registered DIMM
メモリーボード (RDIMM)	MJ7024R0SEX *4	24GB (8GB×3枚)、2133MHz、DDR4、Registered DIMM
	MJ7048R0SEX *4	48GB (16GB×3枚)、2133MHz、DDR4、Registered DIMM

*1 長期保守対応モデル、およびおまかせ安心長期保守モデルは、このオプションのみサポートしています。

なお、長期保守対応モデルおよびおまかせ安心長期保守モデルは、RS220 AN1 モデルにのみラインナップしています。

*2 メモリー RAS モードを「Mirroring」に設定して出荷するための専用形名です。

*3 メモリー RAS モードを「LockStep」に設定して出荷するための専用形名です。

*4 メモリー RAS モードを「Sparing」に設定して出荷するための専用形名です。



- メモリーボード* (RDIMM) とメモリーボード (LRDIMM) を混在搭載することはできません。種類の異なるメモリーボードを混在搭載すると、システム装置が正常に動作しません。
- メモリー容量が 4GB の RDIMM(MJ7008R0) と 32GB の LRDIMM(MJ7064N0) は、メモリー RAS モードの「Mirroring」、「LockStep」、「Sparing」をサポートしていません。これらのメモリー RAS モードは使用しないでください。



- OS によって使用可能なメモリー容量に制限があります。使用する OS の仕様をご確認ください。
- システム装置に搭載されているメモリーボードは、システム装置添付の『構成情報一覧表』で確認できます。
また、購入されたメモリーボードの形名は、購入品に添付された『添付品一覧』で確認できます。
- システム装置に搭載されている総メモリー容量は、システム BIOS セットアップメニューまたは Web コンソールから確認できます。
詳細は『ユーザーズガイド～BIOS 編～』または『ユーザーズガイド～リモートマネージメント編～』をご参照ください。
- メモリーボードの動作クロックは、メモリーの動作モードなどの設定やシステム構成により異なります。
詳細は「A.1 メモリーの動作クロック」P.52 をご参照ください。
- PCIデバイスが使用するメモリー領域の存在により、搭載するメモリーボード容量の一部が使用できない場合があります。詳細は「A.2 メモリーホール」P.53 をご参照ください。

2.2 メモリーボードの取り付け位置

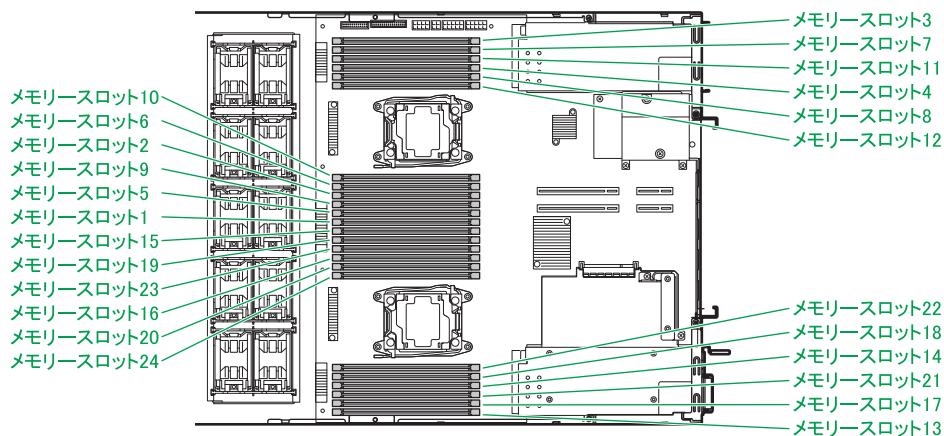
メモリーボードは、マザーボードにあるメモリースロットに取り付けます。

2.2.1 メモリースロット

メモリースロットは、マザーボード上に24スロットあります。

メモリースロット1～12がプロセッサー1に、メモリースロット13～24がプロセッサー2に接続されます。

メモリースロットの位置は次のとおりです。



メモリースロットとマザーボード上の表記は次のとおり対応します。

メモリースロット		マザーボード表記	
1	13	CPU1_DIMM1	CPU2_DIMM1
2	14	CPU1_DIMM2	CPU2_DIMM2
3	15	CPU1_DIMM3	CPU2_DIMM3
4	16	CPU1_DIMM4	CPU2_DIMM4
5	17	CPU1_DIMM5	CPU2_DIMM5
6	18	CPU1_DIMM6	CPU2_DIMM6
7	19	CPU1_DIMM7	CPU2_DIMM7
8	20	CPU1_DIMM8	CPU2_DIMM8
9	21	CPU1_DIMM9	CPU2_DIMM9
10	22	CPU1_DIMM10	CPU2_DIMM10
11	23	CPU1_DIMM11	CPU2_DIMM11
12	24	CPU1_DIMM12	CPU2_DIMM12

2.2.2 メモリー ボードの搭載ルール

メモリースロットはプロセッサーにより 2 つに分かれ、さらにそれぞれ 4 つのチャネルに分かれてプロセッサーに接続されています。メモリースロットとプロセッサーおよびチャネルの対応は次のとおりです。

プロセッサー	チャネル	メモリースロット
1	0	1, 5, 9
	1	2, 6, 10
	2	3, 7, 11
	3	4, 8, 12
2	0	13, 17, 21
	1	14, 18, 22
	2	15, 19, 23
	3	16, 20, 24

メモリー ボードはそれぞれのプロセッサーに対し同じ構成となるよう取り付けます。

また、メモリースロット番号の小さい番号の順で取り付けます。

なお、使用的するメモリーの RAS モードと搭載するプロセッサー数により、取り付けるメモリー ボードの種類やスロット、順番が異なります。



搭載ルールにしたがわずにメモリー ボードを増設すると、システム装置が正常に動作しません。

制限

▶ メモリー RAS モード

メモリーの RAS モードは、システム BIOS のセットアップメニューの「Advanced」-「Memory Configuration」-「Memory RAS Mode」から設定します。

RAS モードは次の 4 種類あります。

- Independent
チャネルがそれぞれ独立して動作します。(インターリーブ)
- Mirroring
チャネル 0、1 間およびチャネル 2、3 間をミラーリングして動作します(メモリーミラーリング)。
チャネル間インターリーブは行われないため、「Independent」モードよりメモリー アクセス性能は低下します。また、OS が使用可能なメモリー容量は 2 チャネル分となります。
- Sparing
各チャネルに搭載されるメモリー ボードの 1 ランクを、スペアメモリーとして動作します(オンラインスペアメモリー)。チャネル間インターリーブを行いますが、1 ランクが予備となるため「Independent」モードよりメモリー アクセス性能は低下します。スペアメモリーとして設定できるランクはチャネルごとに 1 ランクです。
- Lock Step
チャネル 0、1 間およびチャネル 2、3 間を同調して、データ 64 ビット／ECC8 ビットアクセスを、データ 128 ビット／ECC16 ビットに拡張して動作します(ロックステップ)。SDDC による複数ビットエラー検出・訂正機能を強化します。
 - ◆ Independent、Mirroring、Sparing：
x4 SDDC (1 箇所の 4bit DRAM Device Failure 訂正可能)

- ◆ Lock Step :
 - x4/x8 SDDC (1箇所の4bit/8bit DRAM Device Failure 訂正可能)
 - また、2箇所の4bit DRAM Device Failure 検出可能
- チャネル間インターリープは行われないため、「Independent」モードよりメモリーアクセス性能は低下します。

●
補足

- メモリーの動作モードは択一です。
- メモリーRASモードの機能の詳細は、『ユーザーズガイド～運用編～』をご参照ください。
- メモリー容量が4GBのRDIMM(MJ7008R0)は、DIMMの仕様によりx4 SDDCは機能しません。

(1) 「Independent」で使用する場合

容量が異なるメモリーボードは2種類まで混在可能です。この場合、搭載優先順位の高いメモリースロットに容量の大きいメモリーボードを搭載してください。

(メモリー容量大)													(メモリー容量小)
メモリースロット 1・2 (13・14), 3・4 (15・16), 5・6 (17・18), 7・8 (19・20), 9・10 (21・22), 11・12 (23・24)													

* カッコ内はプロセッサースロット2搭載時に追加

- プロセッサー搭載数が「1」の場合

表中の数字の順に、メモリーボードを2枚1組で搭載します。

プロセッサー	1												
チャネル	0	1	2	3									
メモリースロット	1	5	9	2	6	10	3	7	11	4	8	12	
搭載順位	①	③	⑤	①	③	⑤	②	④	⑥	②	④	⑥	

* ○の中の数字が搭載する順番やペアを表します。

- プロセッサー搭載数が「2」の場合

表中の数字の順に、メモリーボードを4枚1組で搭載します。

プロセッサー	1												2												
	0	1	2	3	0	1	2	3																	
チャネル	0	1	2	3	0	1	2	3																	
メモリースロット	1	5	9	2	6	10	3	7	11	4	8	12	13	17	21	14	18	22	15	19	23	16	20	24	
搭載順位	①	③	⑤	①	③	⑤	②	④	⑥	②	④	⑥	①	③	⑤	①	③	⑤	②	④	⑥	②	④	⑥	

* ○の中の数字が搭載する順番やペアを表します。

(2) 「Mirroring」または「Lock Step」で使用する場合

メモリーボードはすべて同じ容量のものを搭載してください。



- 「Mirroring」または「Lock Step」の場合、容量が異なるメモリーボードを搭載しないでください。サポートしていないため、動作を保証しません。
- メモリー容量が4GBのRDIMM (MJ7008R0)と32GBのLRDIMM (MJ7064N0)は使用しないでください。「Mirroring」と「LockStep」をサポートしていません。

■ プロセッサー搭載数が「1」の場合

表中の数字の順に、メモリーボードを2枚1組で搭載します。

プロセッサー	1											
チャネル	0			1			2			3		
メモリースロット	1	5	9	2	6	10	3	7	11	4	8	12
搭載順位	①	③	⑤	①	③	⑤	②	④	⑥	②	④	⑥

* ○の中の数字が搭載する順番やペアを表します。

■ プロセッサー搭載数が「2」の場合

表中の数字の順に、メモリーボードを4枚1組で搭載します。

プロセッサー	1												2											
	0			1			2			3			0			1			2			3		
チャネル	1	5	9	2	6	10	3	7	11	4	8	12	13	17	21	14	18	22	15	19	23	16	20	24
搭載順位	①	③	⑤	①	③	⑤	②	④	⑥	②	④	⑥	①	③	⑤	①	③	⑤	②	④	⑥	②	④	⑥

* ○の中の数字が搭載する順番やペアを表します。

(3) 「Sparing」で使用する場合

メモリーボードはすべて同じ容量のものを搭載してください。



- 「Sparing」の場合、容量が異なるメモリーボードを搭載しないでください。サポートしていないため、動作を保証しません。
- メモリー容量が4GBのRDIMM (MJ7008R0)と32GBのLRDIMM (MJ7064N0)は使用しないでください。「Sparing」をサポートしていません。

■ プロセッサー搭載数が「1」の場合

表中の数字の順に、メモリーボードを3枚1組で搭載します。

プロセッサー	1											
チャネル	0			1			2			3		
メモリースロット	1	5	9	2	6	10	3	7	11	4	8	12
搭載順位	①	①	①	②	②	②	③	③	③	④	④	④

* ○の中の数字が搭載する順番やペアを表します。

■ プロセッサー搭載数が「2」の場合

表中の数字の順に、メモリー ボードを 6 枚 1 組で搭載します。

プロセッサー	1								2															
チャネル	0		1		2		3		0		1		2		3									
メモリースロット	1	5	9	2	6	10	3	7	11	4	8	12	13	17	21	14	18	22	15	19	23	16	20	24
搭載順位	①	①	①	②	②	②	③	③	③	④	④	④	①	①	①	②	②	②	③	③	③	④	④	④

* ○の中の数字が搭載する順番やペアを表します。

2.3 メモリーボードの取り付け

メモリーボードの取り付けは保守員が行います。お問い合わせ先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

⚠ 注意

内蔵オプションの増設・交換はすべて保守員が行います。システム装置のカバーの取り外しや内蔵オプションの取り付け・取り外しは行わないでください。不慣れな作業を行うことにより、けがをしたり装置の故障の原因となります。



システム装置の構成を変更した場合、最大 / 最少消費電力の値を再測定するため、システム BIOS の「Power Measurement Policy」を「One Time」に設定し、システム装置を起動する必要があります。消費電力の再測定を行わないと、正しい値を BMC が認識できず、省電力機能が機能しないおそれがあります。

システム BIOS 設定の詳細は、『ユーザーズガイド～BIOS 編～』をご参照ください。

3

内蔵デバイスの取り付け

この章では、システム装置に搭載可能な内蔵デバイスの種類と取り付け位置について説明します。なお、内蔵デバイスへの取り付けは保守員が行います。お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

3.1 内蔵デバイスの種類	16
3.2 内蔵デバイスの取り付け位置	18
3.3 内蔵デバイスの取り付け	23

3.1 内蔵デバイスの種類

システム装置に搭載可能な内蔵デバイスには、内蔵ハードディスクと内蔵 SSD のストレージタイプと、内蔵 DVD-ROM、内蔵 DVD-RAM、内蔵 LTO、内蔵 RDX のリムーバブルタイプがあります。

3.1.1 内蔵ハードディスク／内蔵 SSD

RS220 AN1 モデルに搭載可能な内蔵ハードディスク および内蔵 SSD は次のとおりです。

品名	形名	仕様
内蔵ハードディスク	UH7300BA1	HDD、SAS 12Gbps、300GB、15000r/min、2.5型
	UH7450BA1	HDD、SAS 12Gbps、450GB、15000r/min、2.5型
	UH7600BA1	HDD、SAS 12Gbps、600GB、15000r/min、2.5型
	SUH7600BA1R *1	HDD、SAS 12Gbps、600GB、15000r/min、2.5型、 長期保守専用
	UH7300BB1	HDD、SAS 12Gbps、300GB、10000r/min、2.5型
	UH7600BB1	HDD、SAS 12Gbps、600GB、10000r/min、2.5型
	SUH7600BB1R *1	HDD、SAS 12Gbps、600GB、10000r/min、2.5型、 長期保守専用
	UH71200BB1	HDD、SAS 12Gbps、1.2TB、10000r/min、2.5型
	UH71800BB1	HDD、SAS 12Gbps、1.8TB、10000r/min、2.5型
内蔵 SSD	UH7200XCN	SSD、SATA 6Gbps、200GB、eMLC、2.5型
	UH7400NCN	SSD、SAS 12Gbps、400GB、eMLC、2.5型
	UH7800BSA1	SSD、SAS 12Gbps、800GB、eMLC、2.5型

*1 長期保守対応モデル、およびおまかせ安心長期保守モデルは、このオプションのみサポートしています。

サポート形名は「GU-SUH7600BA1R」および「GU-SUH7600BB1R」となります。

なお、長期保守対応モデルおよびおまかせ安心長期保守モデルは、RS220 AN1 モデルにのみラインナップしています。

RS220 BN1 モデルには、内蔵ハードディスクと内蔵 SSD を搭載することはできません。



内蔵ハードディスク（UH71800BB1、1.8TB:10000r/min）は処理パフォーマンスが低下する恐れがあるため、VMware 環境での動作をサポートしていません。



システム装置に搭載されている内蔵ハードディスク／内蔵 SSD は、システム装置添付の『構成情報一覧表』で確認できます。

また、購入された内蔵ハードディスク／内蔵 SSD の形名は、購入品に添付された『添付品一覧』で確認できます。

内蔵 SSD (Solid State Drive) は半導体記録素子であるフラッシュメモリを使用した記憶装置です。

SSD の特性で運用上注意が必要な事項があります。

詳細については『ユーザーズガイド～運用編～』をご参照ください。

3.1.2 内蔵 DVD ドライブ

システム装置に搭載可能な内蔵 DVD ドライブとして、内蔵 DVD-RAM と内蔵 DVD-ROM をサポートしています。内蔵 DVD-RAM と内蔵 DVD-ROM は購入時に選択したどちらか 1 台が標準搭載されます。

システム装置に搭載可能な内蔵 DVD ドライブは次のとあります。

品名	形名	仕様
内蔵 DVD-ROM	UV5090EX	DVD-ROM、SATA 1.5Gbps、再生速度 DVD-ROM : 8 倍速 /CD-ROM : 24 倍速、超薄型
内蔵 DVD-RAM	UV7140EX	DVD-RAM、SATA 1.5Gbps、書込速度 DVD-RAM : 5 倍速、再生速度 DVD-RAM : 5 倍速 /DVD-ROM : 8 倍速 /CD-ROM : 24 倍速、超薄型

3.1.3 内蔵 LTO / 内蔵 RDX

システム装置に搭載可能な内蔵 LTO および内蔵 RDX は次のとあります。

品名	形名	仕様
内蔵 LTO	UU742A *1	LTO (Ultrium3)、非圧縮 400GB、SAS 接続、5 型ハーフハイト
	UU781A *2	LTO (Ultrium4)、非圧縮 800GB、SAS 接続、5 型ハーフハイト
	UU715A *3	LTO (Ultrium5)、非圧縮 1.5TB、SAS 接続、5 型ハーフハイト
	UU7250 *4	LTO (Ultrium6)、非圧縮 2.5TB、SAS 接続、5 型ハーフハイト
内蔵 RDX	UR5310 *5 *6	RDX、USB3.0 接続、3.5 型ハーフハイト

*1 内蔵 LTO セット (SUU742A**** : “*” は任意の英数字) として提供されます。セット内容は、内蔵 LTO (UU742A) のほかにデータカートリッジなどが組み合わされます。

*2 内蔵 LTO セット (SUU781A**** : “*” は任意の英数字) として提供されます。セット内容は、内蔵 LTO (UU781A) のほかにデータカートリッジなどが組み合わされます。

*3 内蔵 LTO セット (SUU715A**** : “*” は任意の英数字) として提供されます。セット内容は、内蔵 LTO (UU715A) のほかにデータカートリッジなどが組み合わされます。

*4 内蔵 LTO セット (SUU7250**** : “*” は任意の英数字) として提供されます。セット内容は、内蔵 LTO (UU7250) のほかにデータカートリッジなどが組み合わされます。

*5 内蔵 RDX セット (SUR5310****: “*” は任意の英数字) として提供されます。

*6 長期保守モデル、およびおまかせ安心長期保守モデルは、このオプションのみサポートしています。
なお、サポート形名は、「GU-SUR5310***R」 (“*” は任意の英数字) のみとなります。長期保守に対応していないモデルのサポート形名「GQ-SUR5310***N」とは異なります。



- 内蔵 RDX (UR5310) を搭載している場合、内蔵カートリッジを挿入した状態でシステム装置の電源を入れたり再起動したりすると、OS が起動しない場合があります。システム装置の電源を入れるときや再起動するときはカートリッジを挿入せず、OS を起動してから挿入してください。
また、システム装置の電源を切る前にカートリッジを取り出すようにしてください。
- 内蔵 RDX(UR5310)は USB3.0 に対応していますが、Linux 環境の場合は USB3.0 をサポートしていません。USB3.0 を無効にして、USB2.0 でご使用ください。
USB3.0 の設定を無効にするためには、システム BIOS の「XHCI Mode」の設定を「Disabled」に変更してください。
詳細は『ユーザーズガイド～BIOS 編～』をご参照ください。
- 内蔵 LTO および内蔵 RDX は、VMware 環境での動作をサポートしていません。



長期保守対応モデルおよびおまかせ安心長期保守モデルは、内蔵 LTO をサポートしていません。

3.2 内蔵デバイスの取り付け位置

内蔵ハードディスクや内蔵DVD-ROMなどの内蔵デバイスは、システム装置前面の拡張ストレージベイに取り付けます。

3.2.1 拡張ストレージベイ

拡張ストレージベイ（2.5型）は8つあります。RS220 AN1 モデルにおいて、内蔵ハードディスクまたは内蔵SSDを搭載できます。

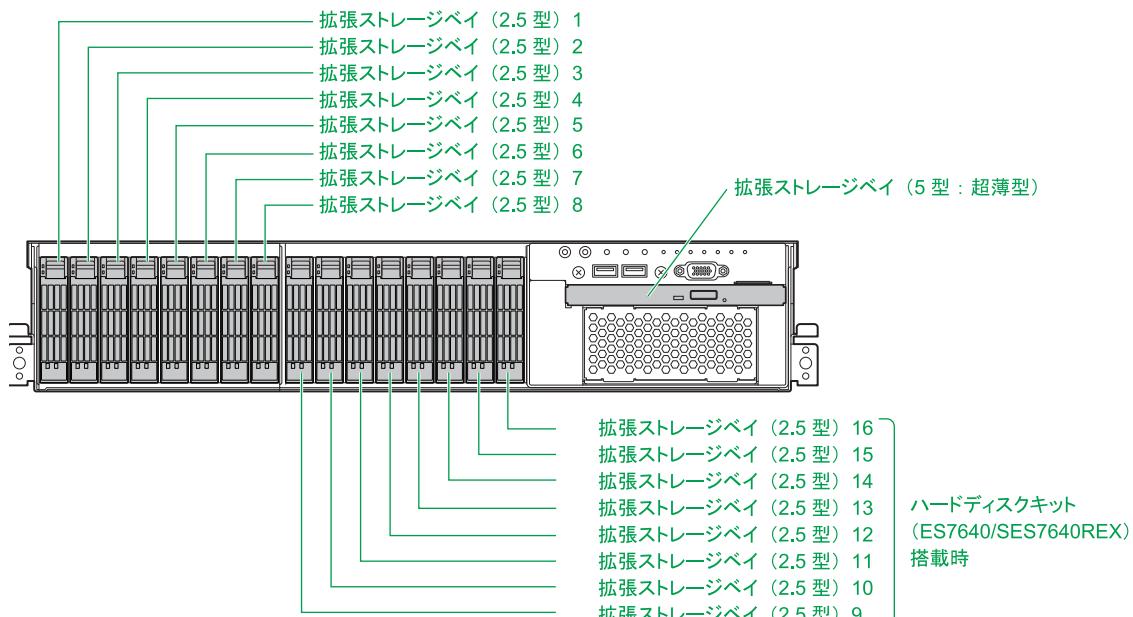
また、ハードディスクキット（ES7640/SES7640REX）を搭載することにより、拡張ストレージベイを16に拡張することができます。

補足

ハードディスクキット（SES7640REX）は、長期保守対応モデル、およびおまかせ安心長期保守モデル専用です。サポート形名は「GU-SES7640REX」です。
なお、長期保守対応モデルおよびおまかせ安心長期保守モデルは、RS220 AN1 モデルにのみラインナップしています。

拡張ストレージベイ（5型・超薄型）と拡張ストレージベイ（5型）はそれぞれ1つあります。内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVD-RAMのどちらかを搭載します。

拡張ストレージベイの位置は次のとおりです。



拡張ストレージベイ（2.5型）とシステム装置前面のベイ表示は次のとおり対応します。

拡張ストレージベイ（2.5型）		システム装置前面ベイ表示	
1	9	0	8
2	10	1	9
3	11	2	10
4	12	3	11
5	13	4	12
6	14	5	13
7	15	6	14
8	16	7	15

通知

ハードディスク／SSDは次のとおり取り扱ってください。取り扱い方法によっては、ハードディスク／SSDの故障やデータの消失の原因となります。

- システム装置やハードディスク／SSDを持ち運ぶときは、振動や衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。また、ハードディスク／SSDを取り扱うときには静電気をあらかじめ取り除くか、綿手袋を着用してください。
- システム装置を移動させるときは電源を切り、電源プラグを抜いて30秒以上待ってから行ってください。



オプションのシステムファンキット（SBF7100/BF7100）を搭載している場合、拡張ストレージベイ（5型）には内蔵LTOを搭載できません。



- 未使用的拡張ストレージベイ（2.5型）には、ほこりの吸引防止のため、ダミーキャニスタが取り付けられています。
- ハードディスクキット（ES7640/SES7640REX）が搭載されていない場合、拡張ストレージベイ（2.5型）9～16にはすべてのベイを覆うブラケットが取り付けられています。

3.2.2 内蔵デバイス搭載ルール

内蔵デバイスはモデルにより、取り付けられる内蔵デバイスの種類や拡張ストレージベイが異なります。

(1) RS220 AN1 モデル

拡張ストレージベイに搭載可能なデバイスは次の表のとおりです。

システム管理を考慮して、ブートディスクとして設定するディスクアレイのハードディスクや SSD は、拡張ストレージベイ 1 から取り付けてください。

凡例：○ = 搭載可能、× = 搭載不可

品名	形名	拡張ストレージベイ (2.5型)								拡張ストレージベイ (5型：超薄型)	拡張ストレージベイ (5型)
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		9	10	11	12	13	14	15	16		
内蔵ハードディスク (300GB: 15000r/min) *1 *2 *3	UH7300BA1	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
		○	○	○	○	○	○	○	○		
内蔵ハードディスク (450GB: 15000r/min) *1 *2 *3	UH7450BA1	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
		○	○	○	○	○	○	○	○		
内蔵ハードディスク (600GB: 15000r/min) *1 *2 *3	UH7600BA1 SUH7600BA1R	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
		○	○	○	○	○	○	○	○		
内蔵ハードディスク (300GB: 10000r/min) *1 *2 *3	UH7300BB1	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
		○	○	○	○	○	○	○	○		
内蔵ハードディスク (600GB: 10000r/min) *1 *2 *3	UH7600BB1 SUH7600BB1R	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
		○	○	○	○	○	○	○	○		
内蔵ハードディスク (1.2TB: 10000r/min) *1 *2 *3	UH71200BB1	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
		○	○	○	○	○	○	○	○		
内蔵ハードディスク (1.8TB: 10000r/min) *1 *2 *3 *5	UH71800BB1	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
		○	○	○	○	○	○	○	○		
内蔵SSD (SATA 200GB) *1 *2	UH7200XCN	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
		○	○	○	○	○	○	○	○		
内蔵SSD (SAS 400GB) *1 *2	UH7400NCN	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
		○	○	○	○	○	○	○	○		
内蔵SSD (SAS 800GB) *1 *2	UH7800BSA1	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
		○	○	○	○	○	○	○	○		
内蔵DVD-ROM *4	UV5090EX	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
		×	×	×	×	×	×	×	×		
内蔵DVD-RAM *4 *5	UV7140EX	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
		×	×	×	×	×	×	×	×		
内蔵LTO *5 *6 *7	UU742A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
		×	×	×	×	×	×	×	×		
内蔵LTO *5 *6 *7	UU781A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
		×	×	×	×	×	×	×	×		

品名	形名	拡張ストレージベイ (2.5型)								拡張ストレージ ベイ (5型:超薄型)	拡張ストレージ ベイ (5型)
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		9	10	11	12	13	14	15	16		
内蔵 LTO *5 *6 *7	UU715A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
		×	×	×	×	×	×	×	×		
内蔵 LTO *5 *6 *7	UU7250	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
		×	×	×	×	×	×	×	×		
内蔵 RDX *5 *8	UR5310	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
		×	×	×	×	×	×	×	×		

*1 1つのディスクアレイを構成するハードディスク／SSDは同容量・同一回転数・同一形名のものを搭載してください。

*2 リザーブディスクとして搭載する場合、ディスクアレイを構成するディスクのタイプ（ハードディスク／SSD）に合わせて搭載する必要があります。リザーブディスクは、ディスクタイプが異なるディスクアレイに対して有効になりません。
ディスクタイプが異なる複数のディスクアレイが存在する場合、それぞれのディスクタイプに合わせてリザーブディスクを搭載し、「専用ホットスペア」に設定してください。

*3 15000r/minと10000r/minの内蔵ハードディスクを混在搭載時にリザーブディスクを設定する場合、「グローバルホットスペア」をサポートしていないため、「専用ホットスペア」に設定してください。

*4 内蔵DVD-ROMと内蔵DVD-RAMは選一です。

*5 VMware環境はサポートしていません。

*6 システム装置に搭載する際は、SASボード(CE7213)とバックアップキット(SLR7210****："*"は任意の英数字)および5型デバイス用ケージ(ES7643)が必要となります。バックアップキットの内容は、内部SASケーブル(LR7210)とバックアップソフトです。

*7 オプションのシステムファンキット(SBF7101/BF7100)を搭載している場合は、搭載できません。

*8 システム装置に搭載する際は、バックアップキット(SLR7105****："*"は任意の英数字)が必要になります。バックアップキットのセット内容は、内部USBケーブル(LR7105)とバックアップソフトです。



内蔵ハードディスクの回転数(15000r/minまたは10000r/min)が異なるものを混在搭載することはサポートしていますが、回転数が異なる内蔵ハードディスクが混在するディスクアレイの構築はサポートしていません。



システム装置に搭載されている内蔵ハードディスク／内蔵SSDは、システム装置添付の『構成情報一覧表』で確認できます。また、購入された内蔵ハードディスク／内蔵SSDの形名は、購入品に添付の『添付品一覧』で確認できます。

▶ディスクパーティションテーブルのフォーマット形式とその最大容量

ディスクパーティションテーブルのフォーマット形式には、GPT (GUID Partition Table) と MBR (Master Boot Record) があります。OS を UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ブートによりインストールすると GPT に、レガシー (Legacy) ブートによりインストールすると MBR に設定されます。

それぞれのパーティションテーブルで認識可能な最大容量は、GPT が 256TB (NTFS の実装上の制限による)、MBR が 2TB です。

このため、OS をインストールする論理ドライブ (ブートパーティション) に MBR を使用する場合、論理ドライブ (LU) 容量は 2TB (2199GB) を超えないように設定する必要があります。超えてしまった場合、OS からパーティションが作成できなくなります。

論理ドライブの設定は、RAID BIOS または RAID 管理ユーティリティから行います。詳細は『ユーザーズガイド～BIOS編～』または、RAID 管理ユーティリティのマニュアルをご参照ください。

なお、UEFI ブート (ブートパーティション: GPT) とレガシーブート (ブートパーティション: MBR) は、OS の種類によってサポートが異なります。システム装置がサポートする OS とブートモードの対応は次のとおりです。

ブートモード	サポートOS
UEFI ブート	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 RHEL7.2 (64-bit x86_64) RHEL7.1 (64-bit x86_64) RHEL6.6 (64-bit x86_64)
レガシーブート	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2008 R2 RHEL6.6 (32-bit x86) VMware vSphere ESXi 6.0 VMware vSphere ESXi 5.5

(2) RS220 BN1 モデル

拡張ストレージベイに搭載可能なデバイスは次の表のとおりです。

凡例：○ = 搭載可能、× = 搭載不可

品名	形名	拡張ストレージベイ (2.5型)								拡張ストレージ ベイ (5型：超薄型)	拡張ストレージ ベイ (5型)
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		9	10	11	12	13	14	15	16		
内蔵 DVD-ROM *1	UV5090EX	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
		×	×	×	×	×	×	×	×		
内蔵 DVD-RAM *1 *2	UV7140EX	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
		×	×	×	×	×	×	×	×		
内蔵 LTO *2 *3 *4	UU742A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
		×	×	×	×	×	×	×	×		
内蔵 LTO *2 *3 *4	UU781A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
		×	×	×	×	×	×	×	×		
内蔵 LTO *2 *3 *4	UU715A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
		×	×	×	×	×	×	×	×		
内蔵 LTO *2 *3 *4	UU7250	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
		×	×	×	×	×	×	×	×		
内蔵 RDX *2 *5	UR5310	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
		×	×	×	×	×	×	×	×		

*1 内蔵DVD-ROMと内蔵DVD-RAMは選一です。

*2 VMware環境はサポートしていません。

*3 システム装置に搭載する際は、SASポート(CE7213)とバックアップキット(SLR7210****："*"は任意の英数字)および5型デバイス用ケージ(ES7643)が必要となります。バックアップキットの内容は、内部SASケーブル(LR7210)とバックアップソフトです。

*4 オプションのシステムファンキット(SBF7101/BF7100)を搭載している場合は、搭載できません。

*5 システム装置に搭載する際は、バックアップキット(SLR7105****："*"は任意の英数字)が必要になります。バックアップキットのセット内容は、内部USBケーブル(LR7105)とバックアップソフトです。

3.3 内蔵デバイスの取り付け

内蔵デバイスの取り付けは保守員が行います。お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

⚠ 注意

内蔵オプションの増設・交換はすべて保守員が行います。システム装置のカバーの取り外しや内蔵オプションの取り付け・取り外しは行わないでください。不慣れな作業を行うことにより、けがをしたり装置の故障の原因となります。



システム装置の構成を変更した場合、最大 / 最少消費電力の値を再測定するため、システム BIOS の「Power Measurement Policy」を「One Time」に設定し、システム装置を起動する必要があります。消費電力の再測定を行わないと、正しい値を BMC が認識できず、省電力機能が機能しないおそれがあります。

システム BIOS 設定の詳細は、『ユーザーズガイド～BIOS 編～』をご参照ください。

- MEMO -

4

拡張ボードの取り付け

この章では、システム装置に搭載可能な拡張ボードの種類と取り付け位置について説明します。なお、拡張ボードの取り付けは保守員が行います。お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

4.1 拡張ボードの種類	26
4.2 拡張ボードの取り付け位置	29
4.3 拡張ボードの取り付け	37

4.1 拡張ボードの種類

システム装置に搭載可能な拡張ボードは次のとおりです。

品名	形名	仕様
ディスクアレイコントローラ ボード（標準：1GB キャッシュ） *1 *2 *3	—	PCI Express 3.0、SAS 12Gbps、キャッシュ容量 1GB、 内蔵用、8 レーン（×8）
ディスクアレイコントローラ ボード（標準：2GB キャッシュ） *1 *2 *3	—	PCI Express 3.0、SAS 12Gbps、キャッシュ容量 2GB、 内蔵用、8 レーン（×8）
ディスクアレイコントローラ ボード（標準：1GB キャッシュ： キャッシュバックアップ付） *1 *2 *3	—	PCI Express 3.0、SAS 12Gbps、キャッシュ容量 1GB、 内蔵用、キャッシュバックアップ付、8 レーン（×8）
ディスクアレイコントローラ ボード（標準：2GB キャッシュ： キャッシュバックアップ付） *1 *2 *3	—	PCI Express 3.0、SAS 12Gbps、キャッシュ容量 2GB、 内蔵用、キャッシュバックアップ付、8 レーン（×8）
LAN 拡張カード（標準：1G 4 ポート）*4	CN7NOTE SCN7NOTREX *5	PCI Express 2.0、1000BASE-T×4 ポート、4 レーン (×4)
LAN 拡張カード（標準：10G 2 ポート + 1G 2 ポート）*4	CN7NOSE SCN7NOSREX CN7N1SEX SCN7N1SREX *5	PCI Express 3.0、10GBASE-SR×2 ポート、 1000BASE-T×2 ポート、8 レーン（×8）
ディスクアレイコントローラ ボード *2	CA7747	PCI Express 3.0、SAS 6Gbps、外付け用、キャッシュ バックアップ付、8 レーン（×8）
	CA7748	PCI Express 3.0、SAS 6Gbps、外付け用、キャッシュ バックアップ付、8 レーン（×8）、LowProfile
SAS ボード *6	CE7213	PCI Express 2.0、SAS 6Gbps、4 ポート、8 レーン (×8)
SAS ボード *2	CE7207	PCI Express 2.0、SAS 6Gbps、2 ポート、8 レーン (×8)
	CE7208	PCI Express 2.0、SAS 6Gbps、2 ポート、8 レーン (×8)、LowProfile
	CE7301	PCI Express 3.0、SAS 12Gbps、2 ポート、8 レーン (×8)
	CE7302	PCI Express 3.0、SAS 12Gbps、2 ポート、8 レーン (×8)、LowProfile
Fibre Channel ボード *2 *7	CC7A11	PCI Express 3.0、FC 16Gbps、1 チャネル、8 レーン (×8)
	CC7A12	PCI Express 3.0、FC 16Gbps、1 チャネル、8 レーン (×8)、LowProfile
	CC7A21	PCI Express 3.0、FC 16Gbps、2 チャネル、8 レーン (×8)
	CC7A22	PCI Express 3.0、FC 16Gbps、2 チャネル、8 レーン (×8)、LowProfile

品名	形名	仕様
Fibre Channel ボード* *7	CC7811	PCI Express 2.0、FC 8Gbps、1 チャネル、8 レーン（×8）
	CC7812	PCI Express 2.0、FC 8Gbps、1 チャネル、8 レーン（×8）、LowProfile
	CC7821	PCI Express 2.0、FC 8Gbps、2 チャネル、8 レーン（×8）
	CC7822	PCI Express 2.0、FC 8Gbps、2 チャネル、8 レーン（×8）、LowProfile
CNA ボード*2	CF7061	PCI Express 2.0、FCoE 10Gbps/iSCSI 10Gbps、2 ポート、8 レーン（×8）
	CF7062	PCI Express 2.0、FCoE 10Gbps/iSCSI 10Gbps、2 ポート、8 レーン（×8）、LowProfile
Fibre Channel ボード（日立製）*2 *7	CC7F11	PCI Express 3.0、FC 16Gbps、1 チャネル、8 レーン（×8）
	CC7F12	PCI Express 3.0、FC 16Gbps、1 チャネル、8 レーン（×8）、LowProfile
	CC7F21	PCI Express 3.0、FC 16Gbps、2 チャネル、8 レーン（×8）
	CC7F22	PCI Express 3.0、FC 16Gbps、2 チャネル、8 レーン（×8）、LowProfile
Fibre Channel ボード（日立製）*7	CC7831	PCI Express 2.0、FC 8Gbps、1 チャネル、8 レーン（×8）
	CC7832	PCI Express 2.0、FC 8Gbps、1 チャネル、8 レーン（×8）、LowProfile
	CC7841	PCI Express 2.0、FC 8Gbps、2 チャネル、8 レーン（×8）
	CC7842	PCI Express 2.0、FC 8Gbps、2 チャネル、8 レーン（×8）、LowProfile
LAN ボード*2 *8	CN7841	PCI Express 2.0、10GBASE-SR、2 ポート、8 レーン（×8）
	CN7842	PCI Express 2.0、10GBASE-SR、2 ポート、8 レーン（×8）、LowProfile
	CN7843	PCI Express 2.0、10G SFP+ Direct Attach 接続、2 ポート、8 レーン（×8）
	CN7844	PCI Express 2.0、10G SFP+ Direct Attach 接続、2 ポート、8 レーン（×8）、LowProfile
	CN7823 *9	PCI Express 2.0、10GBASE-T、2 ポート、8 レーン（×8）
	CN7824 *9	PCI Express 2.0、10GBASE-T、2 ポート、8 レーン（×8）、LowProfile
LAN ボード*2	CN7652	PCI Express 2.0、10GBASE-SR、2 ポート、8 レーン（×8）
	CN7653	PCI Express 2.0、10GBASE-SR、2 ポート、8 レーン（×8）、LowProfile
LAN ボード*2	CN7743	PCI Express 2.0、1000BASE-T、4 ポート、4 レーン（×4）
	CN7744	PCI Express 2.0、1000BASE-T、4 ポート、4 レーン（×4）、LowProfile
	CN7723	PCI Express 2.0、1000BASE-T、2 ポート、1 レーン（×1）
	CN7724	PCI Express 2.0、1000BASE-T、2 ポート、1 レーン（×1）、LowProfile

品名	形名	仕様
Infiniband ボード *10 *11	CQ9561MA	PCI Express 3.0、56Gbps、FDR、8 レーン（×8）
	CQ9561MB	PCI Express 3.0、56Gbps、FDR、8 レーン（×8）、LowProfile
PCIe Flash ドライブボード *11 *12 *13 *14	CG71100VD3EX	PCI Express 2.0、1.1TB Flash Drive、8 レーン（×8）
	CG72200VD3EX	PCI Express 2.0、2.2TB Flash Drive、8 レーン（×8）
	CG74800VD2EX	PCI Express 2.0、4.8TB Flash Drive、8 レーン（×8）

*1 RS220 AN1 モデルのみサポートしています。

*2 長期保守対応モデル、およびおまかせ安心長期保守モデルは、このオプションのみサポートしています。
なお、長期保守対応モデルおよびおまかせ安心長期保守モデルは、RS220 AN1 モデルにのみラインナップしています。

*3 RAID 専用スロットに搭載します。購入時に選択したいずれか（キャッシュ 1GB/2GB、キャッシュバックアップあり／なし）が標準搭載されます。

*4 LAN 拡張カード専用スロットに搭載します。購入時に選択したいずれか（1G 4 ポート／10G 2 ポート + 1G 2 ポート）が標準搭載されます。なお、Wake On LAN と PXE ブートをサポートしています。

*5 長期保守対応モデル、およびおまかせ安心長期保守モデルは、このオプションのみサポートしています。
なお、サポート形名は「GU-SCN7N0TREX」、「GU-SCN7N0SREX」および「GU-SCN7N1SREX」となります。

*6 VMware 環境はサポートしていません。

*7 Fibre Channel ボード (CC7A11/CC7A12/CC7A21/CC7A22/CC7811/CC7812/CC7821/CC7822) と Fibre Channel ボード (CC7F11/CC7F12/CC7F21/CC7F22/CC7831/CC7832/CC7841/CC7842) は同じシステム装置に混在搭載することはできません。

*8 SR-IOV (Single Root I/O Virtualization) 機能をサポートします。動作条件は次のとおりです。
ホスト OS : Windows Server 2012 R2
ゲスト OS : Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2012

詳細については、『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納されるそれぞれの LAN ボードの取扱説明書をご参照ください。
なお、ゲスト OS 上の SR-IOV の仮想ポートにおいて、「NIC チーミング機能」はサポートしていません。

*9 iSCSI インタフェース接続する場合、Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2012 / Linux / VMware の環境においてのみサポートします（Linux は 64-bit x86_64 のみサポートします。32-bit x86 はサポートしません）。

*10 RHEL6.6 環境においてのみサポートします。ただし、RHEL6.6 のカーネルバージョンは「2.6.32-504.30.3.el6」のみサポートします。

*11 標準モデルとおまかせ安心モデルのみサポートしています。
ロングライフサポートモデル // ロングライフモデルⅡ / おまかせ安心ロングライフモデル / 長期保守対応モデル / おまかせ安心長期保守モデルはサポート対象外です。

*12 Windows Server 2012 R2 / Linux / VMware の環境においてのみサポートします。
また、Linux は 64-bit x86_64 のみサポートします。32-bit x86 はサポートしません。

*13 PCIe Flash ドライブボードを搭載する場合、システム装置の設置環境のうち、温度条件が変わります。
動作時、10 ~ 28 °Cで使用する必要があります。→『ユーザーズガイド～導入編～』

*14 ハードディスクキット (ES7640) 搭載時は、PCI Flash ドライブボードを搭載することはできません。

…
補足

- RHEL7 環境の場合、オプション製品（周辺機器、内蔵デバイス）の動作確認情報については、お問い合わせ先にお問い合わせください。
- 購入された拡張ボードの形名は、購入品に添付された『添付品一覧』で確認できます。
- LAN に関する注意事項と拡張機能の詳細は『ユーザーズガイド～運用編～』をご参照ください。

4.2 拡張ボードの取り付け位置

拡張ボードは、マザーボードおよび、PCI ライザボード（PCI ライザスロットに実装）にある拡張スロットに取り付けます。

4.2.1 拡張スロット

拡張スロットはマザーボード上に 2 個、PCI ライザボード上に 6 個あります。

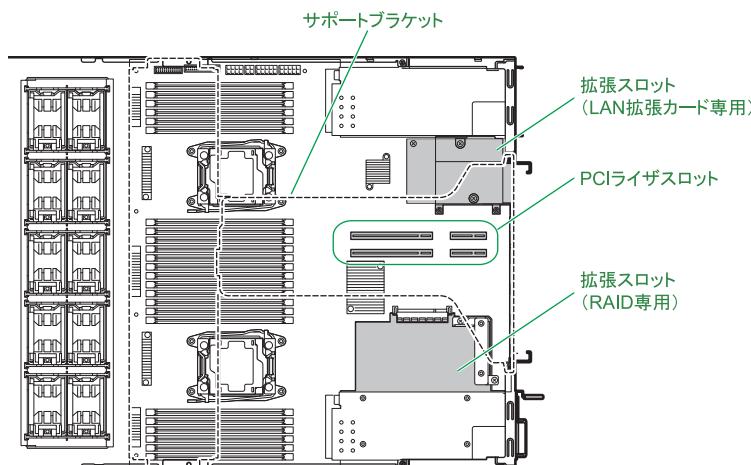
マザーボードにある拡張スロットは、ディスクアレイコントローラボードおよび LAN 拡張カードを搭載する専用スロットです。

各拡張スロットの仕様は次のとおりです。

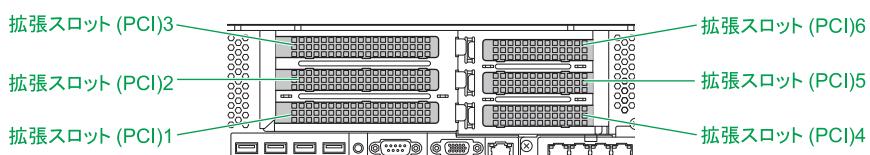
- PCI1 ~ 3 : PCI Express 3.0 x8 (8 レーン)
- PCI4 ~ 6 : PCI Express 3.0 x8 (8 レーン)、LowProfile
- RAID 専用 : PCI Express 3.0 x8 (8 レーン)、ディスクアレイコントローラボード（標準）専用
- LAN 拡張カード専用 : PCI Express 3.0 x8 (8 レーン)、LAN 拡張カード（標準）専用

拡張スロット（PCI）1 ~ 6 とシステム装置背面のスロット表示（刻印）は、次のとおり対応しています。

拡張スロット		システム装置背面スロット表示	
PCI1	PCI4	1C	1D
PCI2	PCI5	2C	2D
PCI3	PCI6	3C	3D



システム装置背面から見たときの拡張スロットの位置は次のとおりです。



各スロットのバス幅／バスクロック、I/O 電圧、バス No.、デバイス No. およびバススキャンの優先順位と、各スロットに取り付けられる拡張ボードのサイズおよび種類は、次のとおりです。

拡張 スロット	バス幅／ バスクロック	I/O 電圧	スロット 形状	バス No. *1	デバイス No. *1	バス スキャン順	取り付けられる拡張ボード
PCI1	単方向 1bit (双方向 2bit) ／8 レーン	3.3V	8 レーン (x8)	C	0	3	PCI Express x1, x2, x4, x8／ スタンダード／ハーフサイズ *4
PCI2 *2				83	0	5	PCI Express x1, x2, x4, x8／ スタンダード／ハーフサイズ *4
PCI3 *2				A0	0	6	PCI Express x1, x2, x4, x8／ スタンダード／フルサイズ *4 *5
PCI4 *3				40	0	4	PCI Express x1, x2, x4／ Low Profile／MD2 *4
PCI5 *2				C0	0	7	
PCI6 *2				E0	0	8	
RAID 専用				1	0	1	ディスクアレイコントローラ ボード
LAN 拡張 カード専用				5	0	2	LAN 拡張カード

*1 バス No. とデバイス No. は 16 進数で表記しています。

*2 プロセッサーを 2 個搭載した場合のみ使用できます。

*3 レーン反転機能 (Lane Reversal) に対応していない拡張カードは搭載できません。

*4 PCI および PCI-X 仕様のボードは取り付けられません。

*5 フルサイズの拡張ボードを取り付ける場合、拡張ボードのリテナーを外す必要があります。

補足

搭載する拡張ボードに接続されるデバイスからブートを行う場合、または拡張ボードの BIOS ユーティリティを使用する場合は、システム BIOS から拡張ボードを搭載している PCI スロットの Option ROM を「Enabled」に設定する必要があります。

また、BIOS ユーティリティを使用するのみで、拡張ボードに接続されるデバイスからブートを行わない場合は、BIOS ユーティリティ使用後、Option ROM を「Disabled」に戻す必要があります。 詳細については『ユーザーズガイド～BIOS 編～』をご参照ください。

4.2.2 拡張ボードの搭載ルール

拡張ボードはモデルにより、取り付けられる拡張ボードの種類や拡張スロットが異なります。

(1) RS220 AN1 モデル / RS220 BN1 モデル [内蔵 USB Flash Module ブート時]

表の上位にある拡張ボードから優先してシステム装置に搭載します。また、拡張スロットには○の中の数字が小さいスロットから優先して搭載します。

凡例：○ = 搭載可能、× = 搭載不可

品名	形名	拡張スロット								最大搭載数
		PCI 1	PCI 2	PCI 3	PCI 4	PCI 5	PCI 6	RAID 専用	LAN 拡張 カード専用	
ディスクアレイコントローラ ボード（標準：1GB キャッシュ） *1	—	×	×	×	×	×	×	①	×	1 枚
ディスクアレイコントローラ ボード（標準：2GB キャッシュ） *1	—	×	×	×	×	×	×	①	×	1 枚
ディスクアレイコントローラ ボード（標準：1GB キャッシュ： キャッシュバックアップ付）*1	—	×	×	×	×	×	×	①	×	1 枚
ディスクアレイコントローラ ボード（標準：2GB キャッシュ： キャッシュバックアップ付）*1	—	×	×	×	×	×	×	①	×	1 枚
LAN 拡張カード（標準：1G 4 ポート）*2 *3	CN7NOTEX SCN7NOTREX *4	×	×	×	×	×	×	×	①	1 枚
LAN 拡張カード（標準：10G 2 ポート + 1G 2 ポート）*2 *5	CN7NOSEX SCN7NOSREX CN7N1SEX SCN7N1SREX *4	×	×	×	×	×	×	×	①	1 枚
Infiniband ボード *6	CQ9561MA	①	×	×	×	×	×	×	×	1 枚
ディスクアレイコントローラ ボード *3 *5 *7 *8	CA7747	①	②	③	×	×	×	×	×	1 枚
SAS ボード *9	CE7213	①	②	③	×	×	×	×	×	1 枚
SAS ボード *11 *12	CE7207	①	②	③	×	×	×	×	×	3 枚
SAS ボード *10 *12 *13	CE7301	①	②	③	×	×	×	×	×	3 枚
Fibre Channel ボード *10 *14 *15 *16	CC7A11	①	②	③	×	×	×	×	×	3 枚
	CC7A21	①	②	③	×	×	×	×	×	3 枚
Fibre Channel ボード *10 *15 *17	CC7811	①	②	③	×	×	×	×	×	3 枚
	CC7821	①	②	③	×	×	×	×	×	3 枚
CNA ボード *3 *5 *10 *15 *16 *18 *19	CF7061	①	②	③	×	×	×	×	×	3 枚
Fibre Channel ボード (日立製) *10 *17 *19	CC7F11	①	②	③	×	×	×	×	×	3 枚
	CC7F21	①	②	③	×	×	×	×	×	3 枚
	CC7831	①	②	③	×	×	×	×	×	3 枚
	CC7841	①	②	③	×	×	×	×	×	3 枚

品名	形名	拡張スロット								最大搭載数
		PCI 1	PCI 2	PCI 3	PCI 4	PCI 5	PCI 6	RAID 専用	LAN 拡張カード専用	
LAN ボード *3 *5 *20	CN7841	①	②	③	×	×	×	×	×	2 枚
	CN7843	①	②	③	×	×	×	×	×	2 枚
	CN7652	①	②	③	×	×	×	×	×	2 枚
	CN7823 *21	①	②	③	×	×	×	×	×	2 枚
LAN ボード *3 *5 *10 *22 *23	CN7743	①	②	③	×	×	×	×	×	2 枚
LAN ボード *3 *5 *10 *21	CN7723	①	②	③	×	×	×	×	×	3 枚
Infiniband ボード *6	CQ9561MB	×	×	×	×	①	×	×	×	1 枚
ディスクアレイコントローラ ボード *3 *5 *7 *8	CA7748	×	×	×	①	②	③	×	×	1 枚
SAS ボード *10 *12 *13	CE7302	×	×	×	①	②	③	×	×	3 枚
SAS ボード *11 *12	CE7208	×	×	×	①	②	③	×	×	3 枚
Fibre Channel ボード *10 *14 *15 *16	CC7A12	×	×	×	①	②	③	×	×	3 枚
	CC7A22	×	×	×	①	②	③	×	×	3 枚
Fibre Channel ボード *10 *15 *17	CC7812	×	×	×	①	②	③	×	×	3 枚
	CC7822	×	×	×	①	②	③	×	×	3 枚
CNA ボード *3 *5 *10 *15 *16 *18 *19	CF7062	×	×	×	①	②	③	×	×	3 枚
Fibre Channel ボード (日立製) *10 *17 *19	CC7F12	×	×	×	③	①	②	×	×	3 枚
	CC7F22	×	×	×	③	①	②	×	×	3 枚
	CC7832	×	×	×	×	①	②	×	×	2 枚
	CC7842	×	×	×	×	①	②	×	×	2 枚
LAN ボード *3 *5 *20	CN7842	×	×	×	①	②	③	×	×	2 枚
	CN7844	×	×	×	①	②	③	×	×	2 枚
	CN7653	×	×	×	①	②	③	×	×	2 枚
	CN7824 *21	×	×	×	①	②	③	×	×	2 枚
LAN ボード *3 *5 *10 *22 *23	CN7744	×	×	×	①	②	③	×	×	2 枚
LAN ボード *3 *5 *10 *21	CN7724	×	×	×	①	②	③	×	×	3 枚
PCIe Flash ドライブボード *24 *25 *26	CG71100VD3EX	×	③	④	①	②	×	×	×	3 枚
	CG72200VD3EX	×	③	④	①	②	×	×	×	4 枚
	CG74800VD2EX	×	③	④	①	②	×	×	×	4 枚

*1 RS220 AN1 モデルの場合、購入時に選択したいずれか（キャッシュ 1GB/2GB、キャッシュバックアップあり／なし）が標準搭載されます。

RS220 BN1 モデルはサポートしていません。

*2 購入時に選択したいずれか（1G 4 ポート／10G 2 ポート + 1G 2 ポート）が標準搭載されます。

*3 プロセッサー 2 個と LAN 拡張カード（CN7NOTEX/SCN7NOTREX）を搭載した構成で VMware を使用する場合、次の搭載制限があります。

- ・ LAN ボード（CN7723/CN7724）の最大搭載数は、合計 4 枚です。
また、LAN ボード（CN7723/CN7724）と LAN ボード（CN7743/CN7744）を混在搭載するときの最大搭載数は、合計 3 枚までです。
- ・ ディスクアレイコントローラボード（CA7747/CA7748）、LAN ボード（CN7823/CN7824/CN7843/CN7844/CN7841/CN7842/CN7652/CN7653）、および CNA ボード（CF7061/CF7062）の最大搭載数は、合計 2 枚までです。
また、LAN ボード（CN7723/CN7724）または LAN ボード（CN7743/CN7744）を搭載するときは、ディスクアレイコントローラボード（CA7747/CA7748）、LAN ボード（CN7823/CN7824/CN7843/CN7844/CN7841/CN7842/CN7652/CN7653）、および CNA ボード（CF7061/CF7062）は、搭載できません。

*4 RS220 AN1 モデルの長期保守対応モデル、およびおまかせ安心長期保守モデルのみサポートしています。

*5 プロセッサー 2 個と LAN 拡張カード（CN7NOSEX/SCN7NOSREX/CN7N1SEX/SCN7N1SREX）を搭載した構成で VMware を使用する場合、次の搭載制限があります。

・ LAN ボード（CN7723/CN7724）の最大搭載数は、合計 1 枚までです。（VMware 構成の上限制限）

- ・ LAN ポート^{*} (CN7743/CN7744) は搭載できません。(VMware 構成の上限制限)
- ・ディスクアレイコントローラボード(CA7747/CA7748)、LAN ポート(CN7823/CN7824/CN7843/CN7844/CN7841/CN7842/CN7652/CN7653)、および CNA ボード (CF7061/CF7062) の最大搭載数は、合計 1 枚までです。
- *6 ノード数最大 36 ノード、スイッチ数最大 1 台となります。
- *7 エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1200] 拡張筐体接続用として増設できます。
- *8 ディスクアレイコントローラポート (CA7747/CA7748) は合計 2 枚まで搭載可能です。
- *9 内蔵 LTO (UU742A/UU781A/UU715A/UU7250) を接続する場合に搭載可能です。
- *10 エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1250] は、日立ディスクアレイシステムまたはエントリークラスディスクアレイ装置 [BR1650] と同じシステム装置に混在接続することはできません。
なお、日立ディスクアレイシステムとエントリークラスディスクアレイ装置 [BR1650] は、同じシステム装置に混在接続できます。
- *11 LTO オートローダ装置、テープエンクロージャ、LTO ライブライ装置を接続する場合に搭載可能です。
- *12 SAS ボード (CE7301/CE7302) 搭載時、SAS ボード (CE7207/CE7208) および SAS ボード (CE7301/CE7302) の最大搭載数は、合計 3 枚となります。
- *13 エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1250] を搭載する場合に搭載可能です。
- *14 日立ディスクアレイシステム (Fibre Channel インタフェースタイプ)、エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1650] 接続用として増設できます。
- *15 Fibre Channel ボード (CC7A11/CC7A12/CC7A21/CC7A22/CC7811/CC7812/CC7821/CC7822) と CNA ボード (CF7061/CF7062) は、合計 5 枚まで搭載可能です。
- *16 次のとおり、システム装置に搭載されるプロセッサーにより、搭載制限があります。
 - ・インテル Xeon E5-2640v3 の場合：
Fibre Channel ボード (CC7A11/CC7A12/CC7A21/CC7A22) および CNA ボード (CF7061/CF7062) は合計 2 枚までの搭載となります。
 - ・インテル Xeon E5-2637v3、E5-2620v3、E5-2603v3 の場合：
Fibre Channel ボード (CC7A11/CC7A12/CC7A21/CC7A22) および CNA ボード (CF7061/CF7062) は搭載できません。
- *17 日立ディスクアレイ装置 (Fibre Channel インタフェースタイプ)、エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1650]、テープエンクロージャ、LTO ライブライ装置接続用として増設できます。
- *18 日立ディスクアレイシステム (FCoE インタフェースタイプ)、日立ディスクアレイシステム (iSCSI インタフェースタイプ)、エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1650] (iSCSI インタフェースタイプ) を接続する場合に搭載可能です。
なお、FCoE 接続する場合は FCoE スイッチを経由する必要があります。
- *19 Fibre Channel ボード (CC7F11/CC7F12/CC7F21/CC7F22/CC7831/CC7832/CC7841/CC7842) と CNA ボード (CF7061/CF7062) は、合計 5 枚まで搭載可能です。
- *20 LAN ポート (CN7841/CN7842/CN7843/CN7844/CN7823/CN7824/CN7652/CN7653) は合計 2 枚まで搭載可能です。
- *21 iSCSI インタフェース接続をサポートしています。iSCSI 接続する場合、日立ディスクアレイシステム (iSCSI インタフェースタイプ)、エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1650] (iSCSI インタフェースタイプ)、バーチャルテーブステーションを接続できます。
- *22 LAN ポート^{*} (CN7743/CN7744) は合計 2 枚まで搭載可能です。
- *23 iSCSI インタフェース接続をサポートしています。iSCSI 接続する場合、日立ディスクアレイシステム (iSCSI インタフェースタイプ)、エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1650] (iSCSI インタフェースタイプ) を接続できます。
- *24 拡張スロットは、スタンダード／LowProfile の 2 種類のサポートブラケットを付け替えることで、スタンダード／LowProfile どちらのスロットにも搭載可能です。
- *25 システム装置に搭載されるプロセッサーがインテル Xeon E5-2637v3、E5-2620v3、E5-2603v3 で、1 個のみの場合、PCIe Flash ドライブボードは搭載できません。
- *26 VMware を使用する場合、PCIe Flash ドライブボードの最大搭載数は、合計 3 枚です。

(2) RS220 BN1 モデル [SAN ブート時]

表の上位にある拡張ボードから優先してシステム装置に搭載します。また、拡張スロットには○の中の数字が小さいスロットから優先して搭載します。

凡例：○ = 搭載可能、× = 搭載不可

品名	形名	拡張スロット						最大搭載数	
		PCI 1	PCI 2	PCI 3	PCI 4	PCI 5	PCI 6	RAID 専用	
LAN 拡張カード（標準：1G 4ポート）*1 *2	CN7N0TEX	×	×	×	×	×	×	×	① 1枚
LAN 拡張カード（標準：10G 2ポート+1G 2ポート）*1 *3	CN7N0SEX CN7N1SEX	×	×	×	×	×	×	×	① 1枚
Fibre Channel ボード [*] (日立製) *4 *5 *6	CC7F11	①	②	③	×	×	×	×	2枚
	CC7F21	①	②	③	×	×	×	×	2枚
	CC7831	①	②	③	×	×	×	×	2枚
	CC7841	①	②	③	×	×	×	×	2枚
SAS ボード*7	CE7213	①	②	③	×	×	×	×	1枚
SAS ボード*8 *9	CE7207	①	②	③	×	×	×	×	3枚
SAS ボード*4 *9 *10	CE7301	①	②	③	×	×	×	×	3枚
CNA ボード*2 *3 *4 *6 *11 *12	CF7061	①	②	③	×	×	×	×	3枚
LAN ボード*2 *3 *13	CN7841	①	②	③	×	×	×	×	2枚
	CN7843	①	②	③	×	×	×	×	2枚
	CN7652	①	②	③	×	×	×	×	2枚
	CN7823 *14	①	②	③	×	×	×	×	2枚
LAN ボード*2 *3 *4 *15 *16	CN7743	①	②	③	×	×	×	×	2枚
LAN ボード*2 *3 *4 *14	CN7723	①	②	③	×	×	×	×	3枚
Fibre Channel ボード [*] (日立製) *4 *5 *6	CC7F12	×	×	×	③	①	②	×	2枚
	CC7F22	×	×	×	③	①	②	×	2枚
	CC7832	×	×	×	×	①	②	×	2枚
	CC7842	×	×	×	×	①	②	×	2枚
SAS ボード*8 *9	CE7208	×	×	×	①	②	③	×	3枚
SAS ボード*4 *9 *10	CE7302	×	×	×	①	②	③	×	3枚
CNA ボード*2 *3 *4 *6 *11 *12	CF7062	×	×	×	①	②	③	×	3枚
LAN ボード*2 *3 *13	CN7842	×	×	×	①	②	③	×	2枚
	CN7844	×	×	×	①	②	③	×	2枚
	CN7653	×	×	×	①	②	③	×	2枚
	CN7824 *14	×	×	×	①	②	③	×	2枚
LAN ボード*2 *3 *4 *15 *16	CN7744	×	×	×	①	②	③	×	2枚
LAN ボード*2 *3 *4 *14	CN7724	×	×	×	①	②	③	×	3枚
PCIe Flash ドライブボード *17 *18 *19	CG71100VD3EX	×	③	④	①	②	×	×	4枚
	CG72200VD3EX	×	③	④	①	②	×	×	4枚
	CG74800VD2EX	×	③	④	①	②	×	×	4枚

- *1 購入時に選択したどちらか（1G 4 ポート／10G 2 ポート + 1G 2 ポート）が標準搭載されます。
- *2 プロセッサー 2 個と LAN 拡張カード（CN7N0TEX）を搭載した構成で VMware を使用する場合、次の搭載制限があります。
 - ・ LAN ボード（CN7723/CN7724）の最大搭載数は、合計 4 枚までです。
また、LAN ボード（CN7723/CN7724）と LAN ボード（CN7743/CN7744）を混在搭載するときの最大搭載数は、合計 3 枚までです。
 - ・ LAN ボード（CN7823/CN7824/CN7843/CN7844/CN7841/CN7842/CN7652/CN7653）、および CNA ボード（CF7061/CF7062）の最大搭載数は、合計 2 枚までです。
また、LAN ボード（CN7723/CN7724）または LAN ボード（CN7743/CN7744）を搭載するときは、LAN ボード（CN7823/CN7824/CN7843/CN7844/CN7841/CN7842/CN7652/CN7653）、および CNA ボード（CF7061/CF7062）は、搭載できません。
- *3 プロセッサー 2 個と LAN 拡張カード（CN7N0SEX/CN7N1SEX）を搭載した構成で VMware を使用する場合、次の搭載制限があります。
 - ・ LAN ボード（CN7723/CN7724）の最大搭載数は、合計 1 枚までです。（VMware 構成の上限制限）
 - ・ LAN ボード（CN7743/CN7744）は搭載できません。（VMware 構成の上限制限）
 - ・ LAN ボード（CN7823/CN7824/CN7843/CN7844/CN7841/CN7842/CN7652/CN7653）および CNA ボード（CF7061/CF7062）の最大搭載数は、合計 1 枚までです。
- *4 エントリークラスディスクアレイ装置〔BR1250〕は、日立ディスクアレイシステムまたはエントリークラスディスクアレイ装置〔BR1650〕と同じシステム装置に混在接続することはできません。
なお、日立ディスクアレイシステムとエントリークラスディスクアレイ装置〔BR1650〕は、同じシステム装置に混在接続できます。
- *5 日立ディスクアレイシステム（Fibre Channel インタフェースタイプ）、エントリークラスディスクアレイ装置〔BR1650〕、テープエンクロージャ、LTO ライブライ装置接続用として搭載します。
- *6 Fibre Channel ボード（CC7F11/CC7F12/CC7F21/CC7F22/CC7831/CC7832/CC7841/CC7842）と CNA ボード（CF7061/CF7062）は、合計 5 枚まで搭載可能です。
- *7 内蔵 LTO（UU742A/UU781A/UU715A/UU7250）を接続する場合に搭載可能です。
- *8 LTO オートローダ装置、テープエンクロージャ、LTO ライブライ装置を接続する場合に搭載可能です。
- *9 SAS ボード（CE7301/CE7302）搭載時、SAS ボード（CE7207/CE7208）および SAS ボード（CE7301/CE7302）の最大搭載数は、合計 3 枚となります。
- *10 エントリークラスディスクアレイ装置〔BR1250〕を搭載する場合に搭載可能です。
- *11 日立ディスクアレイシステム（FCoE インタフェースタイプ）、日立ディスクアレイシステム（iSCSI インタフェースタイプ）、エントリークラスディスクアレイ装置〔BR1650〕（iSCSI インタフェースタイプ）を接続する場合に搭載可能です。
なお、FCoE 接続する場合は FCoE スイッチを経由する必要があります。
- *12 次のとおり、システム装置に搭載されるプロセッサーにより、搭載制限があります。
 - ・ インテル Xeon E5-2640v3 の場合：
CNA ボード（CF7061/CF7062）は合計 2 枚までの搭載となります。
 - ・ インテル Xeon E5-2637v3、E5-2620v3、E5-2603v3 の場合：
CNA ボード（CF7061/CF7062）は搭載できません。
- *13 LAN ボード（CN7841/CN7842/CN7843/CN7844/CN7823/CN7824/CN7652/CN7653）は合計 2 枚まで搭載可能です。
- *14 iSCSI インタフェース接続をサポートしています。iSCSI 接続する場合、日立ディスクアレイシステム（iSCSI インタフェースタイプ）、エントリークラスディスクアレイ装置〔BR1650〕（iSCSI インタフェースタイプ）、バーチャルテープステーションを接続できます。
- *15 LAN ボード（CN7743/CN7744）は合計 2 枚まで搭載可能です。
- *16 iSCSI インタフェース接続をサポートしています。iSCSI 接続する場合、日立ディスクアレイシステム（iSCSI インタフェースタイプ）、エントリークラスディスクアレイ装置〔BR1650〕（iSCSI インタフェースタイプ）を接続できます。
- *17 拡張スロットは、スタンダード／LowProfile の 2 種類のサポートブラケットを付け替えることで、スタンダード／LowProfile どちらのスロットにも搭載可能です。
- *18 システム装置に搭載されるプロセッサーがインテル Xeon E5-2637v3、E5-2620v3、E5-2603v3 で、1 個のみの場合、PCIe Flash ドライブボードは搭載できません。
- *19 VMware を使用する場合、PCIe Flash ドライブボードの最大搭載数は、合計 3 枚です。

▶ SAN ブート使用時における制限事項について

- システム装置に搭載する Fibre Channel ボードは、PCI バス No. の値が小さい拡張スロットに搭載した Fibre Channel ボードのポート 0 をシステムバス（正）*としてご使用ください。
 - * OS インストールするシステム LU に接続するバスを「システムバス」と呼び、2 重化を行うことからプライマリとなるシステムバスを「システムバス（正）」と呼び、セカンダリとなるシステムバスを「システムバス（副）」と呼びます。
- システムバスは 2 重化が必要になるため、1 チャネルの Fibre Channel ボード（CC7F11/CC7F12、または CC7831/CC7832）を搭載する場合は、2 枚以上搭載してください。

- 1 チャネルの Fibre Channel ボード (CC7F11/CC7F12、または CC7831/CC7832) と 2 チャネルの Fibre Channel ボード (CC7F21/CC7F22、または CC7841/CC7842) が混在する場合、2 チャネルのみでシステムパスを構成することはできないため、1 チャネルも含めてシステムパスを構成してください。
また、2 チャネルのみでシステムパスを構成する場合は、すべての Fibre Channel ボードの搭載を 2 チャネルで統一してください（1 チャネルの混在は不可）。
- システムパスに Fibre Channel ボード (CC7F11/CC7F12/CC7F21/CC7F22 : 16Gbps) と Fibre Channel ボード (CC7831/CC7832/CC7841/CC7842 : 8Gbps) のボードを混在することはできません。
16Gbps または 8Gbps のどちらかに統一してください。

4.3 拡張ボードの取り付け

拡張ボードの取り付けは保守員が行います。お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

注意

内蔵オプションの増設・交換はすべて保守員が行います。システム装置のカバーの取り外しや内蔵オプションの取り付け・取り外しは行わないでください。不慣れな作業を行うことにより、けがをしたり装置の故障の原因となります。

通知

拡張ボードを決められた拡張スロット以外に取り付けたり、またサポートしていない拡張ボードを取り付けたりしないでください。正しく動作しなかったり、システム装置や拡張ボードが故障するおそれがあります。



システム装置の構成を変更した場合、最大 / 最少消費電力の値を再測定するため、システム BIOS の「Power Measurement Policy」を「One Time」に設定し、システム装置を起動する必要があります。消費電力の再測定を行わないと、正しい値を BMC が認識できず、省電力機能が機能しないおそれがあります。

システム BIOS 設定の詳細は、『ユーザーズガイド～BIOS 編～』をご参照ください。

— MEMO —

5

電源ユニットの取り付け

この章では、システム装置に搭載可能な電源ユニットの種類と取り付け位置について説明します。なお、電源ユニットの取り付けは保守員が行います。お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

5.1 電源ユニットの種類	40
5.2 電源ユニットの取り付け位置	41
5.3 電源ユニットに接続する電源コード	43
5.4 電源ユニットの取り付け	44

5.1 電源ユニットの種類

システム装置に搭載可能な電源ユニットは、次のとおりです。

電源ユニットは3種類あります。

品名	形名	仕様
電源ユニット	BP2371	電源容量 800W、AC100V/AC200V、80 PLUS Platinum
	BP2363	電源容量 800W、AC200V 専用、80 PLUS Titanium
	BP2372 *1	電源容量 1000W、AC100V/AC200V、80 PLUS Platinum

*1 長期保守対応モデルおよびおまかせ安心長期保守モデルは、このオプションのみサポートしています。また、標準で2個搭載されます。

なお、長期保守対応モデルおよびおまかせ安心長期保守モデルは、RS220 AN1 モデルにのみラインナップしています。

3種類ある電源ユニットは、電源ユニット背面のファン部分に貼られているラベルで識別できます。

- 電源容量 800W タイプ (BP2371) は「800W」および「Platinum」
- 電源容量 800W タイプ /200V 専用 (BP2363) は「800W」および「Titanium」
- 電源容量 1000W タイプ (BP2372) は「1000W」および「Platinum」

オプション品の電源ユニットをシステム装置に増設すると、電源が冗長化されます。このとき、1台の電源ユニットで障害が発生しても、残りの電源で電源供給を行えますので、そのまま運用を続けることができます。

電源ユニットの冗長化の詳細は、『ユーザーズガイド～運用編～』をご参照ください。

...
補足

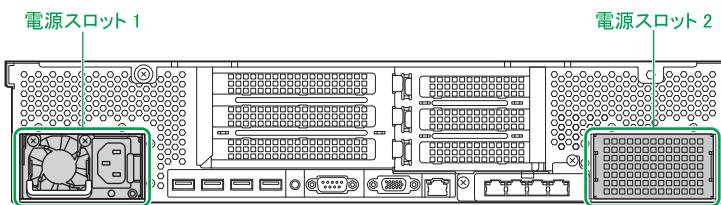
システム装置に標準搭載される電源ユニットと、オプションの電源ユニットは同じ仕様です。

5.2 電源ユニットの取り付け位置

電源ユニットは、システム装置背面の電源スロットに取り付けます。

5.2.1 電源スロット

増設する電源ユニットは、電源スロット 2 に取り付けます。



補足

未使用の電源スロットには、冷却効率向上と安全のため、スロットカバーが取り付けられています。

5.2.2 電源ユニットの搭載ルール

システム装置に搭載されるプロセッサーの種類や搭載数により、必要となる電源ユニットの種類が異なります。対応は次のとおりです。

プロセッサーの種類	プロセッサー搭載数	
	1	2
Xeon プロセッサー E5-2699v3	・ 1000W (BP2372) ・ 800W (BP2371/BP2363)	1000W (BP2372)
Xeon プロセッサー E5-2697v3	・ 1000W (BP2372) ・ 800W (BP2371/BP2363)	1000W (BP2372)
Xeon プロセッサー E5-2690v3	・ 1000W (BP2372) ・ 800W (BP2371/BP2363)	1000W (BP2372)
Xeon プロセッサー E5-2660v3	・ 1000W (BP2372) ・ 800W (BP2371/BP2363)	1000W (BP2372)
Xeon プロセッサー E5-2640v3	・ 1000W (BP2372) ・ 800W (BP2371/BP2363)	1000W (BP2372)
Xeon プロセッサー E5-2637v3	・ 1000W (BP2372) ・ 800W (BP2371/BP2363)	1000W (BP2372)
Xeon プロセッサー E5-2620v3	・ 1000W (BP2372) ・ 800W (BP2371/BP2363)	1000W (BP2372)
Xeon プロセッサー E5-2603v3	・ 1000W (BP2372) ・ 800W (BP2371/BP2363)	1000W (BP2372)

電源スロット 1 には標準で電源ユニットが取り付けられています。

次のモデルは、冗長化のためすべての電源スロットに電源ユニットが標準で取り付けられます。

- ロングライフサポートモデル
- ロングライフモデルⅡ
- おまかせ安心ロングライフモデル
- 長期保守対応モデル
- おまかせ安心長期保守モデル



仕様が異なる電源ユニットの混在搭載はサポートしていません。



システム装置に標準搭載される電源ユニットと、オプションの電源ユニットは同じ仕様です。

5.3 電源ユニットに接続する電源コード

電源ユニットを増設すると、電源コードも追加で必要となります。

電源ユニットに接続する電源コードは、使用する電源電圧により、次のオプションを使用します。

- AC100V 用：電源コード (LG2253)
- AC200V 用：電源コード (LG2252)



- システム装置に AC100V 用 電源コード (LG2253) と AC200V 用 電源コード (LG2252) を混在接続しないでください。異なる電圧供給での動作はサポートしておりません。
- 電源容量 800W タイプ 200V 用(BP2363)に AC100V 用電源コード(LG2253)は接続しないでください。AC100V 供給での動作はサポートしておりません。

5.4 電源ユニットの取り付け

電源ユニットの取り付けは保守員が行います。お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

⚠ 注意

内蔵オプションの増設・交換はすべて保守員が行います。システム装置のカバーの取り外しや内蔵オプションの取り付け・取り外しは行わないでください。不慣れな作業を行うことにより、けがをしたり装置の故障の原因となります。



システム装置の構成を変更した場合、最大 / 最少消費電力の値を再測定するため、システム BIOS の「Power Measurement Policy」を「One Time」に設定し、システム装置を起動する必要があります。消費電力の再測定を行わないと、正しい値を BMC が認識できず、省電力機能が機能しないおそれがあります。

システム BIOS 設定の詳細は、『ユーザーズガイド～BIOS 編～』をご参照ください。

6

システムファンの取り付け

この章では、システム装置に搭載可能なシステムファンと取り付け位置について説明します。
なお、システムファンの取り付けは保守員が行います。お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

6.1 システムファンの種類	46
6.2 システムファンの取り付け位置	47
6.3 システムファンの取り付け	49

6.1 システムファンの種類

システム装置に搭載可能なシステムファンは、次のとおりです。

品名	形名	仕様
システムファン	—	DC12V、ファン1個、プロセッサー（スロット2用）に添付
システムファンキット	SBF7101	DC12V、ファン4個、冗長化用（プロセッサー1用）
システムファンキット	BF7100	DC12V、ファン1個、冗長化用（プロセッサー2用）

プロセッサーを2個搭載する場合、システムファンの増設も必要となります。増設用のシステムファンは、増設用のプロセッサー（プロセッサースロット2用）に添付されます。→「1.1 プロセッサーの種類」P.2

オプション品のシステムファンキット（SBF7101/BF7100）をシステム装置に増設すると、システムファンが冗長化されます。このとき、1個のシステムファンに障害が発生しても、残りのシステムファンでシステム装置の冷却が可能なため、そのまま運用を続けることができます。

システムファンの冗長化の詳細は、『ユーザーズガイド～運用編～』をご参照ください。

...
補足

次のモデルは、システムファンが標準で冗長化されています。

- 長期保守対応モデル
- おまかせ安心長期保守モデル

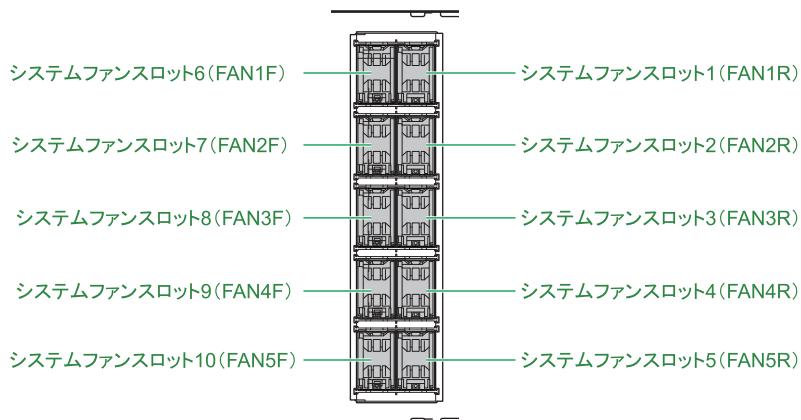
6.2 システムファンの取り付け位置

システムファンはマザーボードにあるシステムファンスロットに取り付けます。

6.2.1 システムファンスロット

システムファンスロットは 10 個あります。

システムファンスロットの位置は次のとおりです。



システムファンスロットと、搭載されるファン No. の対応は次のとおりです。

システムファンスロット		ファン No.	
6	1	1F	1R
7	2	2F	2R
8	3	3F	3R
9	4	4F	4R
10	5	5F	5R

6.2.2 システムファンの搭載ルール

プロセッサー搭載数およびシステムファンキット (SBF7101/BF7100) の搭載の有無による、システムファンの搭載個数および搭載位置は次のとおりです。



システム装置に内蔵 LTO を搭載している場合、システムファンキット (SBF7101/BF7100) は搭載できません。

- システムファンキット (SBF7101/BF7100) 未搭載時（ファン冗長化なし）

凡例：●=標準搭載、○=搭載可能、× =未搭載

プロセッサー 搭載数	システムファン 搭載個数	システムファンスロット									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×
2	5	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×

- システムファンキット (SBF7101) 搭載時（プロセッサー 1 個搭載：ファン冗長化）

凡例：●=標準搭載、○=搭載可能、× =未搭載

プロセッサー 搭載数	システムファン 搭載個数	システムファンスロット									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8	●	●	●	●	×	○	○	○	○	×

- システムファンキット (SBF7101/BF7100) 搭載時（プロセッサー 2 個搭載：ファン冗長化）

凡例：●=標準搭載、○=搭載可能、× =未搭載

プロセッサー 搭載数	システムファン 搭載個数	システムファンスロット									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	10	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○

6.3 システムファンの取り付け

システムファンとシステムファンキットの取り付けは保守員が行います。お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

⚠ 注意

内蔵オプションの増設・交換はすべて保守員が行います。システム装置のカバーの取り外しや内蔵オプションの取り付け・取り外しは行わないでください。不慣れな作業を行うことにより、けがをしたり装置の故障の原因となります。



システム装置の構成を変更した場合、最大 / 最少消費電力の値を再測定するため、システム BIOS の「Power Measurement Policy」を「One Time」に設定し、システム装置を起動する必要があります。消費電力の再測定を行わないと、正しい値を BMC が認識できず、省電力機能が機能しないおそれがあります。

システム BIOS 設定の詳細は、『ユーザーズガイド～BIOS 編～』をご参照ください。

— MEMO —

A

付録 A メモリーの仕様と制限

A.1 メモリーの動作クロック	52
A.2 メモリーホール	53

A.1 メモリーの動作クロック

メモリーボードの動作クロックは、搭載されているプロセッサーの種類と、メモリーボードの種類および搭載するメモリースロットにより、次のとおりになります。

メモリーボードの形名（種類）	メモリーボードの動作クロック	搭載メモリースロット *1	搭載プロセッサーによるメモリーボードの動作クロック		
			インテル Xeon プロセッサー E5-2699v3 E5-2697v3 E5-2690v3 E5-2660v3 E5-2637v3	インテル Xeon プロセッサー E5-2640v3 E5-2620v3	インテル Xeon プロセッサー E5-2603v3
MJ7008R0 MJ7016R0 MJ7032R0 MJ7016R0MEX MJ7032R0MEX MJ7016R0LEX MJ7032R0LEX (RDIMM)	2133MHz	1DPC	2133MHz	1866MHz	1600MHz
		2DPC	2133MHz		
		3DPC	1600MHz	1600MHz	
MJ7024R0SEX MJ7048R0SEX (RDIMM)	2133MHz	3DPC	1600MHz	1600MHz	1600MHz
MJ7064N0 (LRDIMM)	2133MHz	1DPC	2133MHz	1866MHz	1600MHz
		2DPC			
		3DPC	1600MHz	1600MHz	

*1 DPC (DIMM per channel) はチャネルあたりのメモリーボード搭載数を表します。

- ・1DPC：各チャネルに搭載されるメモリーボードが1枚以下の場合
- ・2DPC：チャネルの1つにでもメモリーボードが2枚搭載されている場合
- ・3DPC：チャネルの1つにでもメモリーボードが3枚搭載されている場合

A.2 メモリーホール

システム装置は PCI デバイスが使用するメモリー領域（メモリリソース）を、アドレス FFFF_FFFFh を先頭とした 4GB 以下のメモリー空間に確保します。PCI デバイス用に確保した領域は OS が使用できないためメモリーホールと呼ばれ、メモリーホールの大きさは約 2GB になります。これにより、2GB を超える物理メモリーを搭載した場合、使用可能メモリー容量が減少します。たとえば、4GB の物理メモリーを搭載した場合でも、使用可能メモリー容量は約 2GB となります。

なお、システム装置はメモリーホール領域の物理メモリーを 4GB 以上の領域に再割り当て（リマッピング）します。64 ビット OS を使用している場合や、PAE（Physical Address Extension）機能がある 32 ビット OS で PAE を有効にして使用している場合は、リマッピングされた領域を使用することができ、メモリーホールによる使用可能メモリー容量の減少を回避することができます。

PAE については OS のマニュアルをご参照ください。

…
補足

- ここで説明している「物理メモリー容量」には、メモリー RAS 機能有効時の冗長メモリー容量は含みません。
- OS によって使用可能なメモリー容量に制限がありますので、OS のマニュアルをご参照ください。
- Windows Server 2008 R2 Standardにおいて 32GB 以上の物理メモリーを搭載した場合、OS がアクセス可能なメモリー領域は 32GB 以下であるため、使用可能メモリー容量はメモリーホールの分減少します。

— MEMO —

付録A モリーの仕様と制限

索引

■ S

SAN ブート 34, 35

■ あ

安全にお使いいただくために
一般的な安全上の注意事項 xi
警告ラベルについて xvii
装置の損害を防ぐための注意 xiii
本マニュアル内の警告表示 xv
安全に関する注意事項 x

■ か

拡張ストレージベイ 18
拡張スロット 29
拡張ボード
種類 26
搭載ルール 31
取り付け 37
取り付け位置 29

■ き

規制・対策
高調波電流規格：JIS C 61000-3-2 適合品 iii
雑音耐力 iv
電源の瞬時電圧低下対策 iii
電波障害自主規制 iii
輸出規制 iv

■ し

システム装置
信頼性 iii
システムファン
種類 46
搭載ルール 48
取り付け 49
取り付け位置 47
システムファンスロット 47
重要なお知らせ iii
商標 ii

■ て

ディスクパーティションテーブル 21
電源スロット 41
電源ユニット
種類 40
電源コード 43
搭載ルール 41
取り付け 44
取り付け位置 41

■ と

取り付け位置
拡張ボード 29
システムファン 47
電源ユニット 41
内蔵デバイス 18
プロセッサー 4
メモリー ボード 9

■ な

内蔵 USB Flash Module 31
内蔵デバイス
内蔵 LTO 17
内蔵 RDX 17
種類 16
取り付け 23
取り付け位置 18
内蔵 DVD ドライブ 17
内蔵 SSD 16
内蔵ハードディスク 16

■ は

廃棄・譲渡時のデータ消去 v
版権 ii

■ ふ

プロセッサー
種類 2
取り付け 5
取り付け位置 4

■ ま

マニュアルの表記

 オペレーティングシステムの略称 vii

 記号 vi

 システム装置 vi

 用語 viii

 略語 viii

■ め

メモリー RAS モード 10

メモリースロット 9

メモリー動作クロック 52

メモリーボード

 種類 8

 搭載ルール 10

 取り付け 14

 取り付け位置 9

メモリーホール 53

— MEMO —

日立アドバンストサーバ HA8000 シリーズ

**ユーザーズガイド
～オプションデバイス編～**

HA8000/RS220 AN1/BN1

2015年4月～モデル

初 版 2015年4月

第3版 2016年4月

無断転載を禁止します。

 株式会社 日立製作所
ICT事業統括本部

〒259-1392 神奈川県秦野市堀山下1番地

<http://www.hitachi.co.jp>